

# 天津德高化成新材料股份有限公司



## 公开转让说明书

(申报稿)

主办券商



新时代证券有限责任公司  
New Times Securities Co., Ltd.

二〇一四年九月

## 声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

### 一、控股股东控制的风险

公司股东谭晓华持有公司股份 272 万股，占股份总数的 68%，系公司的控股股东。此外，谭晓华担任公司董事长、总经理，能够决定或实质影响公司的经营方针、决策和经理层的任免。若谭晓华利用其控制地位对公司的经营、管理、人事、财务进行不当控制，则或将损害公司及其他股东的利益。

### 二、产品研发风险

2014 年 1-5 月份、2013 年度、2012 年度，公司的研发费用分别为 73.25 万元、218.77 万元、88.78 万元，占公司营业收入的比例分别为 20.09%、18.76%、14.41%，投入金额较大。

公司电子化学品具有品种多、批量少、升级快、研发投入大、周期长、风险高等特点，需要持续开发和创新。产品研发测试成功后，进行大规模生产时，任何设备工艺参数缺陷、员工素质差异等都可能对产品品质波动，面临产品难以规模化生产风险。同时，新产品研制成功及实现大规模生产后，还面临着市场推广风险。

虽然公司掌握核心技术，并在电子化学品研发及生产领域拥有丰富的经验，但是如果未来研发的新产品不能按计划实现规模化生产或市场环境、市场需求出现重大不利变化导致不能产生预期收益，则公司每年较高的研发投入水平将对公司未来业绩造成一定压力。

### 三、技术泄密风险

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有授权发明专利 4 项，已获受理的专利申请 2 项；同时，在不断研发的过程中，公司还形成了较多的非专利技术和核心配方，这些技术和配方都是公司技术领先的保证。

公司自成立以来就非常注重对专利、非专利技术和和新配方的保护，为了保证公司的核心机密不外泄，公司与董事、监事、高级管理人员、所有研发人员以及其他相关人员均在劳动合同中约定了保密条款。公司采取了配方保密、专人保管等特殊方法，并通过岗位分离及权限设置，避免部分技术人员掌握全部核心技术内容，从而有效保护了技术秘密。如果出现任何侵犯本公司专利或相关知情人

士违反保密义务的情形，可能对公司的正常经营产生不利影响。

#### 四、核心技术人员流失的风险

作为一家立足于技术的高科技企业，拥有稳定、高素质的技术人才队伍是公司长期发展的关键，本公司自成立以来，一贯注重研发人才的培养，为技术开发人员提供了良好的薪酬福利，制定了多种政策鼓励创新和研发，并与核心技术人员签订了保密协议。但随着市场竞争的日益激烈，对核心技术人才的争夺将日趋激烈，如果公司未来不能在公司前景、薪酬、福利和工作环境等方面持续提供具有竞争力的机制，将可能会造成公司核心技术人员的不稳定，从而对本公司的长远发展造成不利影响。

#### 五、新产品市场推广风险

公司已掌握 LED 灯丝灌封胶、FPS 指纹传感器封装 EMC 等高端电子化学品制造的核心技术，解决了产业化过程中规模化生产的关键技术难题，正在进行市场推广。LED 灯丝灌封胶、FPS 指纹传感器封装用 EMC 等属于高端半导体封装的关键工艺材料，由于国内一直未能掌握相关化学材料技术，国内先进半导体封装测试企业相关材料需求全部依赖进口。由于半导体封装测试工艺对环境、材料的严格要求，半导体封装企业一般选择认证合格的供应商保持长期合作，从而降低材料供应商变化可能导致的产品质量风险；同时，新的材料供应商必须通过半导体封装企业严格的公司和产品评估才能成为其合格供应商。

因此，公司 LED 灯丝灌封胶、FPS 指纹传感器 EMC 等新产品大规模市场销售市场推广面临客户的认证意愿、对公司质量管理能力的认可以及严格的产品认证等不确定因素，存在一定的市场推广风险。

#### 六、半导体产业周期性、季节性波动风险

半导体产业具有技术呈周期性发展和市场呈周期性波动的特点。公司主营业务处于半导体产业链的材料支撑行业，其市场需求和全球及国内半导体产业的发展状况息息相关，因此，公司的业务发展会受到半导体行业周期性波动的影响。未来，如果全球及国内半导体行业进入发展低谷，则公司将面临业务发展放缓、业绩产生波动的风险。

公司所在电子化学品细分领域主要为半导体产业配套，受半导体市场波动影

响较大。半导体行业的终端产品消费电子、家用电器、信息通讯等在节假日几乎全部存在促销活动，销售也会比平时答复增加。而全年的节假日，除了五一，其余如十一、元旦、春节，包括国外的圣诞节都在下半年，故下半年日常的电子产品销量会高于上半年。同时，公司客户一般在年末或年初启动增产计划并在下半年实现大批量投产。因此，公司产品销售在年度内存在上半年低下半年高的季节性波动风险。

## 七、关联交易风险

2014年1-5月份、2013年度、2012年度，公司向关联方天津齐泰科技有限公司销售产品金额分别为36.68万元、394.41万元、143.00万元，分别占当期公司销售收入的10.06%、33.83%、23.31%。由于有限公司时期，法人治理结构尚未完善，亦未对关联交易事项制定相关内部管理制度，故以上关联交易事项均未履行相关决策程序。股份公司成立以来，制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》，对关联交易的内部决策程序作出了明确的规范，尽管如此，如果公司未来不能充分履行上述规章制度，则可对公司经营带来风险。

## 八、净资产收益率波动风险

2014年1-5月份、2013年度、2012年度，公司净资产收益率（加权平均）分别为0.45%、15.54%、74.32%，扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）分别为-2.96%、3.34%、69.95%，波动较大。2012年度净资产收益率较高系由于该年度公司实现扭亏为盈，公司加权平均净资产较低所致，2013年度净资产收益率有所下降系由于公司由于研发费用支出较大导致净利润较低，且2013年度公司实收资本由100万元增加值300万元。2014年1-5月份公司净资产收益率较低系由于行业季节性所致，一般上半年销售收入较低。随着公司产品体系的完善，未来销售收入将得到大幅提升，同时公司不断调整并优化资本结构，今后的净资产收益率将趋于平稳。

## 九、税收政策变化风险

2012年11月8日，公司取得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》，有效期三年，证书编号为GR201212000248。根据高新技术企业所得税税收优惠的有关规

定，在 2012 年度至 2014 年度公司使用 15% 的所得税税率。如果今后国家税务主管机关对所得税税收优惠政策做出调整，或者公司为持续获得高新技术企业资质，公司将不再享有上述税后优惠政策，这对公司未来的经营业绩和利润水平将会产生一定程度的影响，公司面临税收政策风险。

## 目录

声明.....	- 1 -
重大事项提示.....	- 2 -
释义.....	- 8 -
<b>第一章 基本情况.....</b>	<b>- 11 -</b>
一、公司基本情况 .....	- 11 -
二、挂牌股份情况 .....	- 11 -
三、公司股权及股东情况 .....	- 13 -
四、公司设立以来股本的形成及变化和重大资产重组情况 .....	- 14 -
五、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	- 18 -
六、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表.....	- 20 -
七、与本次挂牌的有关机构 .....	- 21 -
<b>第二章 公司业务.....</b>	<b>- 24 -</b>
一、公司主营业务、主要产品或服务情况.....	- 24 -
二、公司组织结构、主要商业模式及运营流程.....	- 27 -
三、与公司业务相关的关键资源要素.....	- 31 -
四、公司的业务经营情况 .....	- 36 -
五、公司的商业模式 .....	- 43 -
六、公司所处的行业情况 .....	- 45 -
<b>第三章 公司治理.....</b>	<b>- 61 -</b>
一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	- 62 -
二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估 .....	- 63 -
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况 .....	- 65 -
四、公司独立性情况 .....	- 65 -
五、同业竞争情况 .....	- 66 -
六、报告期内公司资金占用、对外担保情况.....	- 67 -
七、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	- 67 -
八、公司董事、监事、高级管理人员在近两年内的变动情况 .....	- 69 -
<b>第四章 公司财务.....</b>	<b>- 70 -</b>
一、公司最近两年一期经审计的财务报表.....	- 70 -
二、公司最近两年及一期财务会计报告的审计意见.....	81
三、公司主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响 .....	81
四、公司最近两年的主要财务数据和财务指标分析.....	97
五、报告期内各期末主要资产情况.....	101
六、报告期内各期末主要负债情况.....	111
七、报告期内各期末所有者权益情况.....	114
八、报告期内利润形成的有关情况.....	117
九、公司的税收优惠情况及财政补贴情况.....	127
十、关联方、关联方关系及关联方交易情况.....	130
十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	137

十二、报告期内资产评估情况.....	137
十三、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况.....	137
十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况.....	138
十五、特有风险提示 .....	138
<b>第五章 有关声明.....</b>	<b>142</b>
一、申请挂牌公司及全体董事、监事及高级管理人员声明.....	142
二、主办券商声明 .....	143
三、律师事务所声明 .....	144
四、会计师事务所声明 .....	145
五、资产评估机构声明 .....	146
<b>第六章 附件 .....</b>	<b>147</b>
一、主办券商推荐报告 .....	147
二、财务报表及审计报告 .....	147
三、法律意见书 .....	147
四、公司章程 .....	147
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	147
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	147

## 释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、德高化成	指	天津德高化成新材料股份有限公司
有限公司	指	天津德高化成电子材料有限公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为
新时代证券、主办券商	指	新时代证券有限责任公司
内核小组	指	新时代证券有限责任公司全国股份转让系统挂牌项目内部审核小组
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
大信会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中银律师事务所	指	北京市中银律师事务所
控股股东、实际控制人	指	谭晓华
齐泰科技	指	天津齐泰科技有限公司
齐泰国贸	指	天津齐泰国际贸易有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	《天津德高化成新材料股份有限公司章程》
报告期、最近两年及一期	指	2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月份
元	指	人民币元
半导体	指	在硅中添加三价或五价元素形成的电子器件，与导体和非导体的电路特性不同，其导电具有方向性，半导体主要分为集成电路（IC）、分立器件（TR）两大分支。
半导体封装	指	将器件或电路装入保护外壳的工艺过程，确保芯片与外界隔离，以防止空气中的杂

		志对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降，也便于安装和运输。
电子化学品	指	电子工业使用的专用化工材料，即电子元器件、印刷线路板、工业及消费类整机生产和包装用各种化学品及材料。
IC	指	集成电路 (Integrated Circuit)，是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。
LED	指	发光二极管，由含镓 (Ga)、砷 (As)、磷 (P)、氮 (N)、硅 (Si) 等的化合物制成的二极管，当电子与空穴复合时能辐射出可见光，因而可以用来制成发光二极管。
IC 封装	指	把硅片上的电路管脚，用导线接引到外部接头处，以便与其它器件连接。封装形式是指安装半导体集成电路芯片用的外壳。它不仅起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用，而且还通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上，这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接，从而实现内部芯片与外部电路的连接。
LED 封装	指	发光芯片的封装，相比集成电路封装有较大不同。LED 的封装不仅要求能够保护灯芯，而且还要能够透光。所以 LED 的封装对封装材料有特殊的要求。
EMC	指	Epoxy Molding Compound，即环氧树脂模塑料、环氧塑封料，是由环氧树脂为基体树脂，以高性能酚醛树脂为固化剂，加入硅微粉等为填料，以及添加多种助剂混配而成的粉状模塑料。
Melamine	指	指三聚氰胺，是制造三聚氰胺甲醛树脂的主要原料，用作有机元素分析试剂，也用于有机及树脂的合成作皮革加工的鞣剂和填充剂。与甲醛缩合聚合可制得三聚氰胺树脂，可用于塑料及涂料工业，也可作纺织物防摺、防缩处理剂。
BGA	指	Ball Grid Array，即球栅阵列的印制电路板，

		是集成电路采用有机载板的一种封装方法。它具有①封装面积小；②引脚数目多；③集成电路板溶焊时能自我居中，易上锡；④可靠性高；⑤电性能好，整体成本低等特点。
FPS	指	Finger Print Sensor，即指纹传感器。
SEMI	指	国际半导体设备材料产业协会，是全球性的产业协会，致力于促进微电子、平面显示器及太阳能光电等产业供应链的整体发展。

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

# 第一章 基本情况

## 一、公司基本情况

公司名称	天津德高化成新材料股份有限公司
英文名称	Tecore Synchem Inc.
法定代表人	谭晓华
有限公司成立日期	2008年3月18日
股份公司设立日期	2014年8月13日
注册资本	400万元
公司住所	天津市滨海新区塘沽新北路4668号创新创业园13号厂房
邮编	300450
董事会秘书	潘雪莹
所属行业	化学原料及化学制品制造业（C26） 高分子复合材料系列产品、电子元器件及半导体材料的研
经营范围	发、制造、销售及相关产品的技术咨询、技术服务；劳务服务。国家有专营专项规定的按专营专项规定办理。
主营业务	半导体封装材料的研发、生产、销售
组织机构代码	67370315-7
电话	022-66351157
传真	022-66351159
网址	www.tecore-synchem.com
电子邮箱	freddy_pan@tecore-synchem.com

## 二、挂牌股份情况

### （一）股票挂牌概况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：人民币 1.00 元

股票总量：400 万股

股票转让方式：协议转让

挂牌日期：【】年【】月【】日

## （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

### 1、法律、法规及章程对股东所持股份的限售规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《业务规则》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》中对股东所持股份转让的限制性规定与公司法及业务规则相同。

### 2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

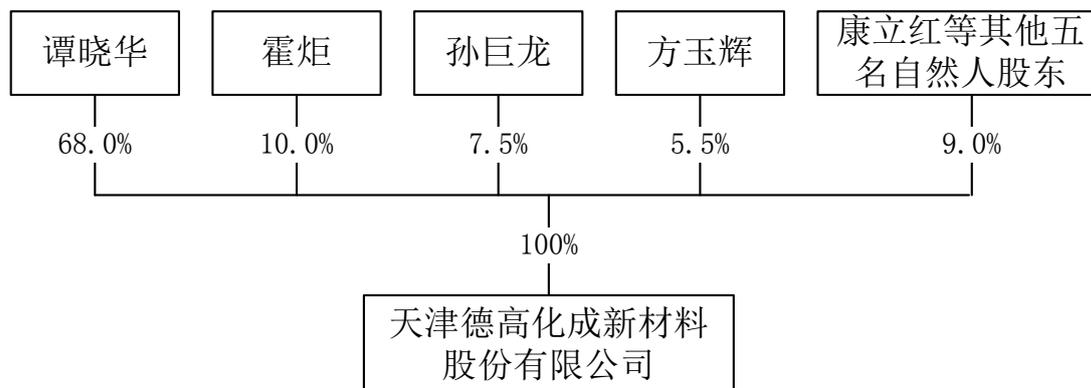
公司股东未就所持股份作出相关法律法规规定之外的自愿锁定承诺。

### 3、股东所持股份的限售安排

股份公司成立于 2014 年 8 月 13 日，截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立未满一年，公司现有股东所持股份均不得转让。

### 三、公司股权及股东情况

#### (一) 公司的股权结构图



#### (二) 公司股东情况

##### 1、前十名股东及持有 5%以上股份股东情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	谭晓华	2,720,000	68.00	自然人	否
2	霍炬	400,000	10.00	自然人	否
3	孙巨龙	300,000	7.50	自然人	否
4	方玉辉	220,000	5.50	自然人	否
5	康立红	100,000	2.50	自然人	否
6	冯亚凯	80,000	2.00	自然人	否
7	孙绪筠	80,000	2.00	自然人	否
8	潘雪莹	50,000	1.25	自然人	否
9	沈六富	50,000	1.25	自然人	否
	合计	4,000,000	100.00	-	-

公司股东之间不存在关联关系。

##### 2、控股股东、实际控制人情况

有限公司设立之时，第一大股东为李湘风，为谭晓华之岳母，持有有限公司 38% 的股权。该笔出资由谭晓华实际支付，李湘风仅为在工商局登记的名义股东，并在谭晓华授权下行使股东权利。双方代持关系于 2014 年 5 月解除。

谭晓华自设立之日起一直实际担任有限公司总经理，公司的实际经营决策由

谭晓华控制。方玉辉未实际参与公司经营，仅为工商备案的执行董事、经理，在谭晓华授权下行使相关权利。

2013年9月，有限公司增资至300万元。届时，谭晓华直接持有有限公司66.67%的股权，并开始正式担任公司执行董事、经理职务。

2014年8月，股份公司成立后，谭晓华持有公司272万股，占公司股份总额的68%，是公司的控股股东，并担任公司董事长、总经理职务。

报告期内，谭晓华能够对公司实际控制，能够支配公司行为，是公司的实际控制人。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

主办券商认为：公司对实际控制人认定的理由和依据充分、合法。

律师认为：公司对实际控制人认定的理由和依据充分、合法。

## 四、公司设立以来股本的形成及变化和重大资产重组情况

### （一）公司设立以来股本的形成及变化情况

#### 1、有限公司的设立

有限公司由李湘风、方玉辉、翟玉静、连爱琪共同出资设立，设立时的基本信息如下：

名称	天津德高化成电子材料有限公司
住所	天津市塘沽区新北路4668号创新创业园31-A一层B角
法定代表人	方玉辉
注册/实收资本	100万元
经营范围	高分子复合材料系列产品，电子元器件及半导体材料的研发、制造、销售及相关产品的技术咨询、技术服务；劳务服务。
营业期限	2008年3月18日至2038年3月17日

2008年3月13日，天津市正泰有限责任会计师事务所出具了“津正泰验字（2008）第400081号验资报告”，并载明：截至2008年3月12日止，有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本），合计人民币100万元，各股东以货币出资100万元。

2008年3月18日，天津市工商行政管理局塘沽分局核准了公司的设立申请，

并核发了营业执照。

设立之时，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	实缴出资额	持股比例	出资方式
1	李湘风	38 万元	38%	货币
2	方玉辉	22 万元	22%	货币
3	翟玉静	20 万元	20%	货币
4	连爱琪	20 万元	20%	货币
	合计	100 万元	100%	-

## 2、有限公司增资

2013 年 8 月 1 日，有限公司召开股东会并做出决议，同意公司新增股东谭晓华，同意公司增加注册资本至 300 万元，全部由新股东谭晓华认缴，同意选举谭晓华为公司执行董事，选举方玉辉为公司监事，同意修改章程。

2013 年 9 月 18 日，天津康永联合会计师事务所出具了“康永（2013）065 号验资报告”，验证：截至 2013 年 9 月 17 日止，有限公司已收到谭晓华缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 200 万元，以货币出资。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	实缴出资额	持股比例	出资方式
1	谭晓华	200 万元	66.67%	货币
2	李湘风	38 万元	12.66%	货币
3	方玉辉	22 万元	7.33%	货币
4	翟玉静	20 万元	6.67%	货币
5	连爱琪	20 万元	6.67%	货币
	合计	300 万元	100%	-

本次增资未产生溢价。

## 3、有限公司股权转让

2014 年 5 月 16 日，有限公司召开股东会并做出决议：同意李湘风将其持有的 38 万元出资转让给谭晓华，同意连爱琪将其持有的 20 万元出资转让给霍炬，同意翟玉静将其持有的 20 万元出资转让给孙巨龙，同意修改章程。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	实缴出资额	持股比例	出资方式
1	谭晓华	238 万元	79.33%	货币
2	方玉辉	22 万元	7.33%	货币
3	孙巨龙	20 万元	6.67%	货币
4	霍炬	20 万元	6.67%	货币
	合计	300 万元	100%	

李湘风为谭晓华之岳母，孙巨龙与翟玉静系夫妻关系，霍炬与连爱琪系夫妻关系。公司设立之时，李湘风、翟玉静、连爱琪所持股权的实际出资人分别为谭晓华、孙巨龙、霍炬，本次转让完成后，公司股东之股权不存在代持情况。

本次股权转让未支付对价，仅在工商行政管理部门进行备案。

#### 4、有限公司第二次增资

2014 年 5 月 28 日，有限公司召开股东会并做出决议：同意吸纳冯亚凯、孙绪筠、潘雪莹、沈六富、康立红为公司股东，同意增加注册资本至 400 万元，由新增股东认缴，同意修改章程。

2014 年 5 月 29 日，天津市滨海新区工商行政管理局核准了公司变更事项，并核发了新的营业执照。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	姓名	出资额（元）	持股比例（%）	出资方式
1	谭晓华	2,720,000	68.00	货币
2	霍炬	400,000	10.00	货币
3	孙巨龙	300,000	7.50	货币
4	方玉辉	220,000	5.50	货币
5	康立红	100,000	2.50	货币
6	冯亚凯	80,000	2.00	货币
7	孙绪筠	80,000	2.00	货币
8	潘雪莹	50,000	1.25	货币
9	沈六富	50,000	1.25	货币
	合计	4,000,000	100.00	货币

本次增资未产生溢价。

## 5、整体变更为股份公司情况

2014年6月15日，有限公司召开临时股东会，决定以截至2014年5月31日的经审计的净资产折股整体变更为股份公司。

2014年7月11日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大信审字[2014]第11-00211号审计报告”，审计意见为标准无保留。经审计，有限公司截至2014年5月31日的净资产为4,311,348.45元。

2014年7月12日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了“国众联评报字（2014）第2-287号资产评估报告”。经评估，有限公司截至2014年5月31日的净资产的市场价值为500.20万元。

2014年7月15日，有限公司各个股东签署了发起人协议，对整体变更为股份公司事项各个股东之间的权利义务进行了约定。

2014年7月18日，公司召开第一次股东大会通过了股份公司章程，选举了第一届董事会成员，选举了第一届监事会成员，通过了其他相关议案。同日，第一届董事会选举了公司董事长，第一届监事会选举了监事会主席。

2014年8月13日，天津市滨海新区工商行政管理局对公司整体变更事项进行了核准，并核发了营业执照。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	谭晓华	2,720,000	68.00	净资产
2	霍炬	400,000	10.00	净资产
3	孙巨龙	300,000	7.50	净资产
4	方玉辉	220,000	5.50	净资产
5	康立红	100,000	2.50	净资产
6	冯亚凯	80,000	2.00	净资产
7	孙绪筠	80,000	2.00	净资产
8	潘雪莹	50,000	1.25	净资产
9	沈六富	50,000	1.25	净资产
	合计	4,000,000	100.00	

截至本公开转让说明书签署之日，公司股权结构未发生变动。

## （二）公司重大资产重组情况

公司自设立以来，未发生重大资产重组。

## 五、公司董事、监事、高级管理人员情况

公司董事、监事、高级管理人员任职及持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	职务
1	谭晓华	2,720,000	68.00	董事长、总经理
2	霍炬	400,000	10.00	董事
3	孙巨龙	300,000	7.50	董事
4	方玉辉	220,000	5.50	监事会主席
5	冯亚凯	80,000	2.00	董事
6	孙绪筠	80,000	2.00	董事
7	潘雪莹	50,000	1.25	董事会秘书
8	沈六富	50,000	1.25	监事
9	李永	-	-	职工监事
10	韦谨	-	-	财务负责人
	合计	3,900,000	97.50	

### （一）公司董事基本情况

2014年7月18日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举谭晓华、霍炬、孙巨龙、冯亚凯、孙绪筠组成第一届董事会，任期三年。各位董事基本情况如下：

谭晓华，男，1972年生，研究生学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。其主要职业经历为：1994-1996年任中国石油天然气总公司工程技术研究院工程师；1996-2008年就任于电工集团（上海浦东新区）有限公司；2008-2014年就任于有限公司；现任公司董事长、总经理。

霍炬，男，1977年生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。其主要职业经历为：1998-2002年就任于汕头超声印制板公司；2003-2009年就任于日东电工（上海浦东新区）有限公司；2009-2014年8月就任于有限公司；现任公司董事、市场销售部负责人。

孙巨龙，男，1977年生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

其主要职业经历为：1999-2001 年就任于天津大港油田水电厂天水实业公司；2001-2010 年就任于日东电工（上海浦东新区）有限公司；2010-2014 年 8 月就任于有限公司；现任公司董事、制造部负责人。

冯亚凯，男，1966 年生，博士研究生学历，教授，中国国籍，无境外永久居留权。其主要职业经历为：2003 年至今就任于天津大学化工学院；现兼任公司董事。

孙绪筠，男，1980 年生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。其主要职业经历为：2006-2010 年就任于日东电工（上海浦东新区）有限公司；2010-2014 年 8 月就任于有限公司；现任公司董事、研发部负责人。

## （二）公司监事基本情况

2014 年 7 月 18 日，有限公司召开职工代表大会，选举李永担任公司职工监事，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举方玉辉、沈六富担任公司监事，共同组成公司第一届监事会，任期三年。同日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举方玉辉担任公司监事会主席。各位监事基本情况如下：

方玉辉，男，1968 年生，MBA，中国国籍，无境外永久居留权。其主要职业经历为：1990-1992 年就任于天津通信公司；1993-1997 年就任于 NOKIA 北京公司；1997-2002 年就任于天津开发区创业中心；2002 年至今就任于天津齐泰科技有限公司；现兼任公司监事会主席。

沈六富，男，1974 年生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。其主要职业经历为：1998 年-2000 年就任于信息产业部电子第十四研究所；2000 年-2002 年就任于香港积德电子有限公司上海代表处；2002-2007 年就任于日东电工（上海浦东新区）有限公司；2010-2014 年就任于烟台德邦科技有限公司；2014 年 3 月-2014 年 8 月就任于有限公司；现任公司监事、销售经理。

李永，男，1981 年生，初中学历，中国国籍，无境外永久居留权。其主要职业经历为：2008-2014 年 8 月就任于有限公司；现任公司职工监事、生产组长。

## （三）高级管理人员基本情况

2014 年 7 月 18 日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任谭晓华担任公司总经理、财务负责人，聘任潘雪莹担任公司董事会秘书，任期均为三年。2014 年 9 月 10 日，公司召开第一届董事会第三次会议，同意谭晓华辞去公司财务负

责人职务，同意聘任韦谨为公司财务负责人。

各位高级管理人员基本情况如下：

谭晓华基本情况见“公司董事基本情况”部分。

潘雪莹，女，1974年生，大学专科学历，中国国籍，无境外居留权。其主要职业经历为：1997-2012年就任于日东电工（上海浦东新区）有限公司；2013年-2014年8月就任于有限公司；现任公司董事会秘书、品质保证部负责人。

韦谨，女，1986年生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。其主要职业经历为：2009年-2011年就任于天津家长通讯杂志社，2011年-2013年就任于天津今晚百分无线传媒，2013年-2014年8月就任于天津德高化成电子材料有限公司，现任公司财务负责人。

## 六、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产（元）	5,492,112.04	5,037,525.97	4,848,801.40
股东权益合计（元）	4,311,348.45	3,296,427.16	1,037,359.85
归属于申请挂牌公司股东权益合计（元）	4,311,348.45	3,296,427.16	1,037,359.85
每股净资产（元/股）	1.08	1.10	1.04
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.08	1.10	1.04
资产负债率（%）	21.50	23.56	78.61
流动比率（倍）	6.88	3.01	1.11
速动比率（倍）	5.70	2.45	0.89
项目	2014年1-5月份	2013年度	2012年度
营业收入（元）	3,646,447.06	11,660,105.55	6,161,618.94
净利润（元）	14,921.29	259,067.31	701,930.29
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	14,921.29	259,067.31	701,930.29
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-97,906.14	55,678.85	660,650.50

归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-97,906.14	55,678.85	660,650.50
毛利率（%）	65.29	56.62	67.04
净资产收益率（%）	0.45	15.54	74.32
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-2.96	3.34	69.95
基本每股收益（元/股）	0.00	0.17	0.70
稀释每股收益（元/股）	0.00	0.17	0.70
应收账款周转率（次）	3.33	11.88	9.10
存货周转率（次）	5.41	17.54	11.46
经营活动产生的现金流量净额(元)	-315,903.41	211,571.96	82,602.68
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.10	0.14	0.08

注 1：每股净资产、归属于申请挂牌公司的每股净资产、基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额指标均以实收资本为基础计算，其中基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额指标以期间加权平均股份数为基础计算。

2：有限公司以经审计的账面净资产折股整体变更为股份公司前后，实收资本未发生变化，均为 400 万元。

3：净资产收益率=当期净利润/当期加权平均净资产；每股收益=当期净利率/当期加权平均股份数；每股净资产=期末净资产/期末股份数。

## 七、与本次挂牌的有关机构

### （一）主办券商

机构名称：新时代证券有限责任公司

法定代表人：刘汝军

住所：北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层

联系电话：010-83561000

传真：010-83561001

项目负责人：张优

项目小组成员：张优、郭嘉恒、徐永军

**(二) 律师事务所**

机构名称：北京市中银律师事务所

负责人：崔炳全

住所：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 soho 东区 A 座 31 层

联系电话：010-58698899

传真：010-58699666

经办律师：周俊利、牛宝源

**(三) 会计师事务所**

机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：吴卫星

住所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层

联系电话：010-82800690

传真：010-82800107

经办注册会计师：王进、李志军

**(四) 资产评估机构**

机构名称：国众联资产评估土地房地产估价有限公司

负责人：黄西勤

住所：深圳市罗湖区深南东路 2019 号东乐大厦 1008 室

联系电话：0755-25132297

传真：0755-25132297

经办注册资产评估师：邢贵祥、庾江力

**(五) 证券登记结算机构**

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

**(六) 证券交易场所**

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二章 公司业务

### 一、公司主营业务、主要产品或服务情况

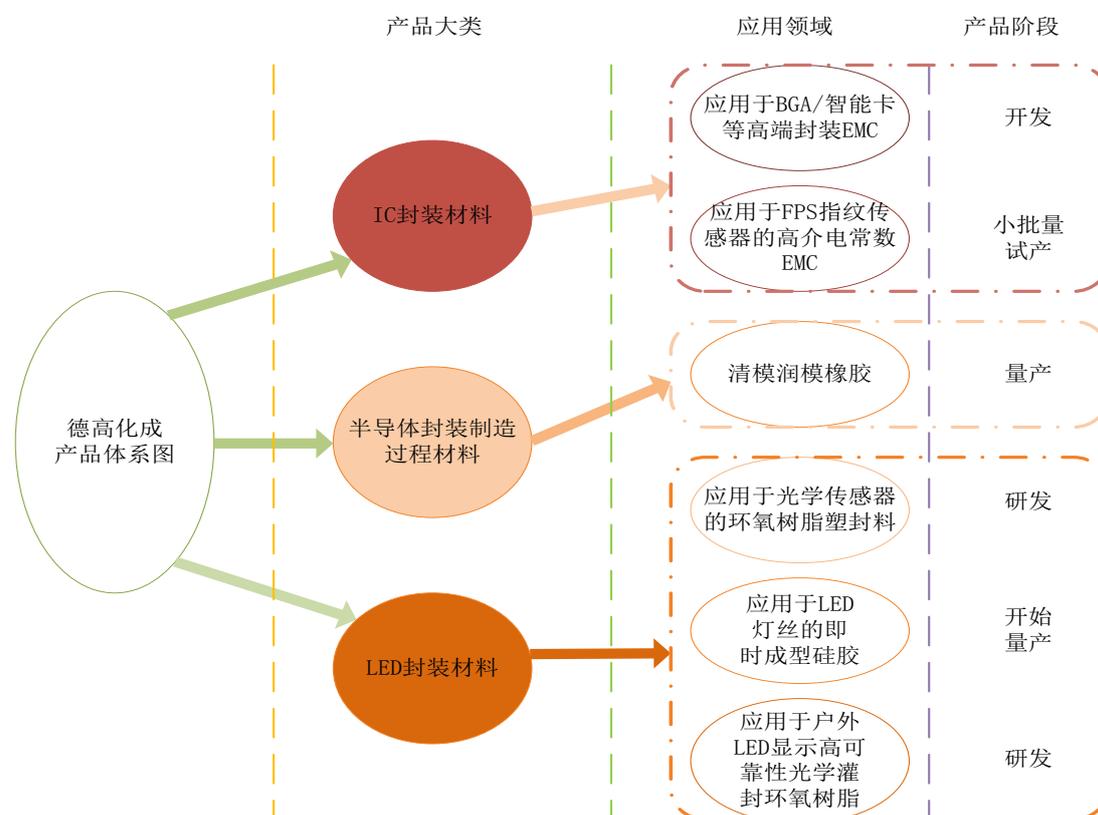
#### (一) 公司的主营业务

作为立足于自主创新的高新技术企业，公司专业从事半导体行业所需电子化学品的研发、生产和销售业务，同时提供相关咨询服务，致力于为客户提供化学材料、应用工艺、现场服务一体化的整体解决方案。

公司自成立初期，抓住全球半导体产业转移、国内半导体封装产业快速发展、半导体清润模处理工艺技术升级和电子产品无铅化法规实施等机遇，以半导体封装清模润模材料为基础产品，进入国内半导体封装材料市场，并通过自主研发、生产、销售和服务，有力的推动了国内半导体封装企业在清润模方面的技术升级和生产效率。同时，公司大力推动产品研发，截至本公开转让说明书签署之日，公司已经初步形成了清模润模材料、LED 封装材料、IC 器件封装材料等三大业务体系。

#### (二) 公司的主要产品或服务情况

公司的产品体系如下图所示：



## 1、半导体封装清润模材料

该产品以合成橡胶为基体，混合入对半导体模具具有清洁、润滑作用的添加剂，通过橡胶混炼、挤出成型工艺生产而成的功能材料。

公司该产品以橡胶为基材，自主研发了绿色环保的、既有清模又有润模功能的多功能新材料，该材料首次实现清模和润模功能一次完成，同时还针对不同用户的模具和工艺条件，选择合适的清模剂和增润剂以及不同的复配比例，优化橡胶配方研发出专用清模润模多功能新材料。



该产品填补国内空白，打破日、韩企业的供应垄断地位，诸多性能表现突出，并获得 Amkor、Vishay 等全球知名半导体厂商的使用。该产品研发获国家科技部创新基金支持，并形成发明专利，是报告期内形成收入的主要产品。

## 2、LED 封装、灌封材料

LED 信号、背光、照明器件封装使用环氧树脂或有机硅树脂灌封，树脂须具备高流动性、耐紫外光老化、耐冷热冲击等性能。公司 2014 年 4 月上市一款 LED 灯丝球泡灯专用有机硅封装胶，系业界首款针对 1mm 宽玻璃基板灯丝的高触变封装胶。



公司该项产品的主要特点为：触变效果显著且稳定一致；透过率高；可实现最简单、最低成本的 LED 灯丝制造工艺。相较于市场同类产品，公司该产品最大特点为“高触变性”。该产品的运用可极大程度缩短 LED 灯丝封装工序，提高封装、制造效率。在该领域内，公司首次提出 LED 灯丝封装的“即时成型”概念，目前公司该项技术已向国家知识产权局递交专利申请并获受理，在该领域内公司处于技术领先地位。截至本公开转让说明书签署之日，公司该产品已研发成功，并向国家知识产权局申请专利二项。该产品已通过下游客户认证，开始量产。

同时，公司针对户外高分辨率大屏幕显示 LED 的高可靠性光学环氧树脂也在开发当中，目前由于用于高分辨率屏幕的小尺寸表面贴装型 LED 无法满足户外的严苛环境，使得高分辨率 LED 屏幕仅仅限于室内使用。公司该材料的开发成功可以有效地提高小尺寸 LED 的耐潮气、防尘等耐候性能，将使高分辨率彩色 LED 显示屏的应用从室内走到户外。

### 3、IC 封装材料——EMC

EMC 是 Epoxy Molding Compound 的简称，由环氧树脂为基体树脂，以高性能酚醛树脂为固化剂，加入硅微粉等为填料，以及添加多种助剂混配而成的粉状模塑料，是 IC 器件封装的必须材料。

公司是国内首家开发出快速固化、应用于金属载带的非接触智能卡封装用 EMC 的厂商，该产品用于高安全要求的身份证、银行卡的领域，目前这个领域的 EMC 材料仍由日立化成、住友电木等日本厂商所垄断。公司该产品目前已通过下游客户中电智能卡有限责任公司测评，使用效果良好。中电智能卡有限责任公司由中国广通股份有限公司、公安部第一研究所、中国华大集成电路设计中心、西南计算器工业公司四家单位共同出资设立，专业从事 IC 卡和 IC 卡模块设计、生产和销售，系国内最大的第二代身份证、芯片式银行卡提供商。该公司目前使用日立化成株式会社（日本）的 EMC 产品进行封装，今后或将采用公司产品进行材料替代。

截至本公开转让说明书签署之日，公司应用于 FPS 指纹传感器的高介电常数 EMC 已研发成功，并通过客户认证，已开始小规模试产。公司该项产品主要应用于各类移动终端指纹传感器，在业内率先实现了通过 EMC 材料达到和改善产品电性能的尝试，从而使 EMC 的应用不仅仅限于器件的包覆和保护，而是成为

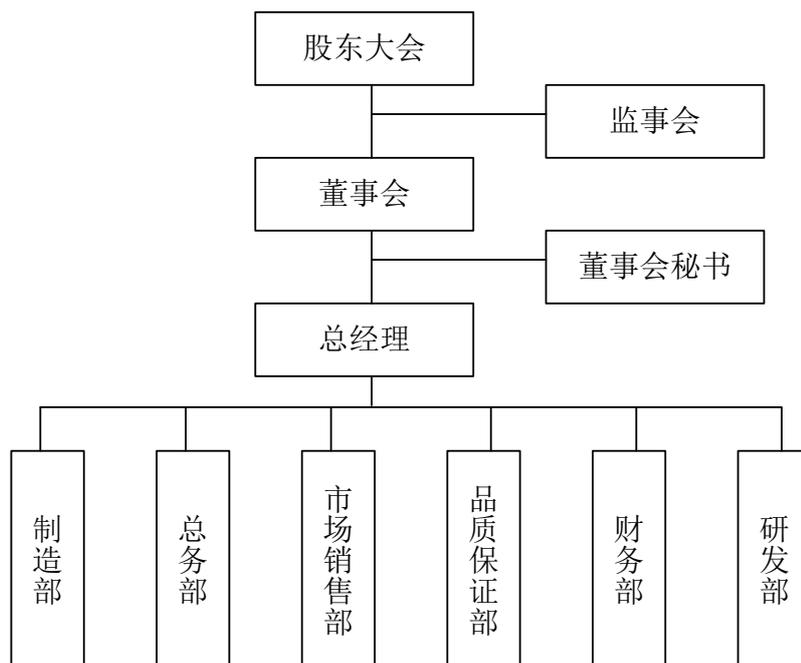
传感器实现电性能的关键功能组件。目前该领域内无同类产品出现。

## 二、公司组织结构及运营流程

### （一）公司的组织结构

公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司业务发展的需要，建立了规范的法人治理结构和健全的内部管理机构，公司共设立了 6 个职能部门。

#### 1、公司的组织结构图



#### 2、公司主要部门的职能

股东大会是公司的权力机构，董事会是公司的决策机构，监事会是公司的监督机构。股东大会、董事会、监事会和高级管理人员按照《公司章程》的规定，严格履行各自的职权。各职能部门职责情况如下：

序号	部门	主要职责
1	制造部	公司产品的生产与制造，原辅材料与成品库存管理，生产现场安全与环保管理，废水处理，公用工程管理。
2	总务部	综合文秘，企业文化建设，人力资源管理，业务流程、环境体系管理，安全、环保、行政、后勤管理，材料采购。
3	市场销售部	市场开发和产品销售，客户服务，客户管理，市场信息搜集、整理与传输，货款回收，客户投诉的受理与回复，企业宣传。
4	品质保证部	生产技术与工艺管理，公司产品与原料质量管理，技术文件和标准化管理，客户投诉处置，知识产权保护与专利查询、申请，质量体系管理。
5	财务部	会计与记账管理，资金与票据管理，费用与成本管理，固定资产管理，公司税务和财务风险管理，财务分析与策划，公司相关证

		照年审及印鉴的日常管理。
6	研发部	产品及应用技术的研发与试验，检验分析新方法开发与试验，产品的技术支持与培训，产品技术文件的编写与输出，对内、对外的检验分析，对外技术交流合作，原材料选用与认证。

## （二）公司的主要运营流程

公司商业模式的实现主要是通过向供应商采购必要原材料，并在此基础上结合自身的专业技术和生产能力，向客户提供半导体封装材料的相关产品及服务，并取得收入。具体来讲，公司的业务流程由研发、采购、生产、销售等共同构成。

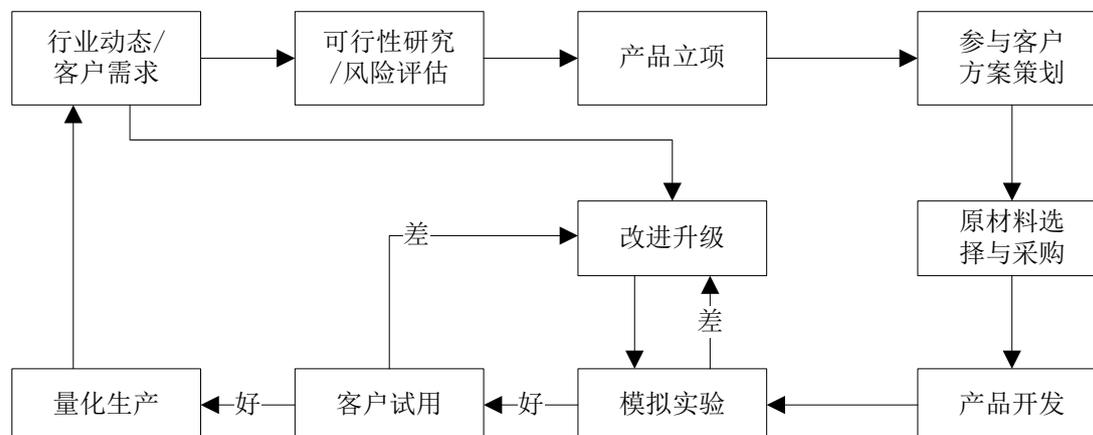
### 1、研发

公司主营的电子化学品，就生产工艺而言，属于精细化工行业；就产品用途而言，是下游半导体器件生产的核心部件或重要过程耗材之一。如何将材料的化学特性转化为独特的结构性能与电性能特性，并取得良好的契合效果，是公司研发部门面临的主要问题。

作为一家主营高端半导体封装材料的高新技术企业，研发部是公司最核心的部门，产品研发贯穿公司全部业务始终。公司产品主要为下游半导体封装、制造企业配套，下游半导体封装、制造企业产品研发决定了本公司产品的研发方向。因此，公司采取嵌入式研发的模式，即公司通过了解客户/潜在客户的产品研发方向、材料需求，有针对性的进行产品研发。

公司设置了专门的研发部门负责公司产品、技术的开发工作。截至 2014 年 5 月 31 日，公司研发部门共有研发人员 5 人。报告期内，公司所有产品、技术均为自主研发，不存在合作研发情况。报告期内，公司研发团队形成了多项技术，成果显著，公司自主研发能力强。

公司具体产品研发流程如下：

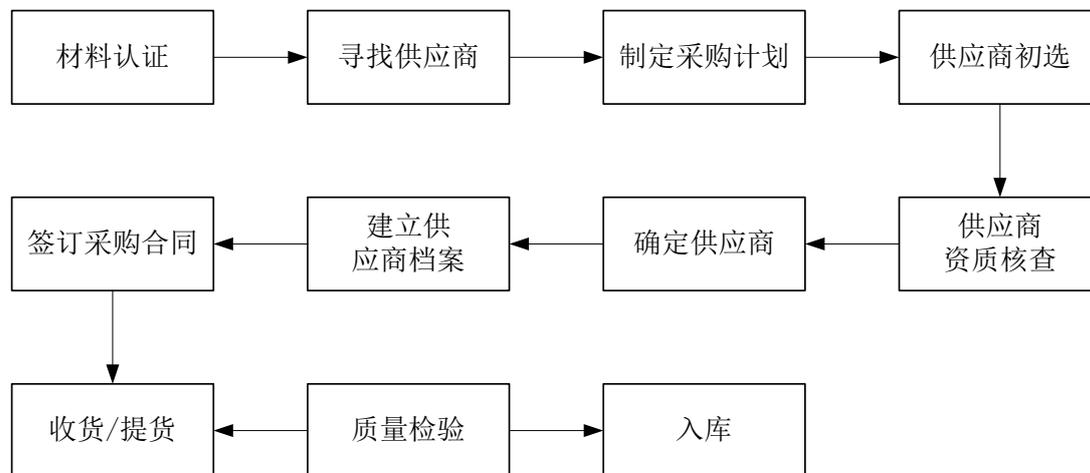


## 2、采购

公司电子化学产品生产所需原材料种类较多，主要包括橡胶、树脂、二氧化硅、氧化铝等化工材料。由于公司从事高端电子化学品的研发生产，故对原材料规格、技术参数等要求较高，部分原材料生产商为境外企业。

公司对主要原材料建立了稳定的供应体系，和主要供应商保持常年稳定的合作关系。同时，公司目前正在就部分原材料供给问题与境外原材料生产企业磋商，若达成意向，将降低原材料采购中的代理商环节的成本。

公司的采购流程如下：



公司实行供应目标管理和合格供方评审制度，设立了专门的采购部门负责搜集各使用部门的物料需求，编制采购计划，并负责组织具体的商务洽谈、付款、供应商管理等工作；研发部、制造部等负责确定物料的技术需求，品质保证部负责原材料的报检、取样、检测数据统计等工作，分析实验室负责原材料的进料检验和分析。

## 3、生产

公司自主组织生产，主要采取以销定产的生产模式。产品生产的内部组织活动如下：营销部门对客户下的订货单进行统计、初审，并由制造部、研发部进行评审。研发部评审时结合产品技术参数等情况，审查原材料的可保障性。制造部评审时要审查订单的可生产性，安排生产时要合理搭配机构、货期，并对生产过程进行监管。通过评审的订单由制造部编排生产计划，并负责落实生产，生产过程中品质保证部负责质量保证。未通过评审的订单反馈给市场营销部，与客户沟通后进行修改调整。

公司相关产品不存在国家标准、行业标准和地方标准，因此公司产品的制造执行公司自行制定的企业标准。研发部和制造部共同负责解决生产中的标准制定，品质保证部负责管理技术文件、牵头处理技术质量异常问题。目前，公司向质检部门备案的企业标准如下：

序号	产品名称	产品执行标准名称	执行标准编号
1	半导体芯片封装模具用清模橡胶	半导体芯片封装模具用清/润模橡胶	Q/12TG 4336-2014
2	半导体芯片封装模具用润模橡胶	半导体芯片封装模具用清/润模橡胶	Q/12TG 4336-2014

#### 4、销售

公司产品为下游半导体企业配套，所售产品大多须通过客户的评估认证，个别产品甚至需要客户的客户认证，一般认证过程严谨、认证周期较长。一旦通过客户认证，正式成为客户合格供应商后，客户向公司定期采购电子化学品。销售模式为常规订单销售，公司的合格供应商资格一般不会被轻易取消。

在半导体封装清模润模处理领域，公司可根据客户的生产工艺、技术水平向客户提供材料、技术一体化的整体解决方案。通常要经过了解客户、为客户策划实施方案、公司模拟实验、客户现场实验、客户小批量试用、中试、大批量供货等阶段。

在封装材料领域，公司一般针对客户的产品方向、研发计划提供配套的封装产品，一旦产品通过客户认证，将在一个产品周期内与客户维持稳定的合作关系。并根据客户订单要求组织生产、销售。

公司产品采取直接销售、代理销售相结合的混合销售模式，并提供技术咨询服务。公司销售人员均为材料工程、半导体等相关专业出身，并在半导体封装、材料应用方面具有丰富的实践经验，公司采用顾问式营销模式向客户销售产品。

公司采用市场定价策略，价格高低取决于市场接受程度。在客户使用成本合理的基础上，公司产品技术含量越高，被替代的可能性越低，产品毛利率越高。由于公司产品技术含量高、产品可靠性强、替代可能性小，公司向下游客户的议价能力强，因此公司产品销售表现出高毛利的特征。

### 三、与公司业务相关的关键资源要素

#### (一) 产品和服务所使用的主要技术

公司是一家致力于为微电子和光电子领域提供创新高分子封装材料的高新技术企业，各类产品所运用的主要技术如下：

产品	主要技术	备注
清模润模橡胶	半导体塑封模具模污溶解配方	已获发明专利
	2-10mm 合成橡胶混炼材料的混合、挤出、压延工艺能力	已获发明专利，已制定企业标准并备案
LED 灌封胶	高触变有机硅加成聚合物配方	专利进入审核阶段
应用于 FPS 的 EMC	高介电常数无机粉料加成聚合物配方	专利申请已提交
	高介电常数、低介电损耗环氧树脂复合物 EMC 应用于指纹传感器封装的配方设计	专利申请已提交
功能性 EMC	薄型 MAP、BGA 封装用绿色环保 EMC 的配方设计与加工工艺	准备申请专利
	适用于金属载带非接触智能卡（如身份证、银行卡）IC 封装的 EMC 配方设计与加工工艺	准备申请专利
	适用于变频智能控制模块 LGBT 封装的 EMC 配方设计与加工工艺	准备申请专利

#### (二) 主要无形资产情况

##### 1、土地使用权

截至本公开转让说明书签署之日，公司无土地使用权。

##### 2、知识产权

###### (1) 专利权

截至本公开转让说明书签署日，公司共有专利权四项，具体情况如下：

序号	名称	类型	发明人	专利号	申请日	权利人	授权公告日	取得
1	环氧树脂和硅树脂固化涂层和封装的脱除剂及制备方法	发明专利	谭晓华；冯亚凯	ZL201110269629.2	2011年9月13日	天津德高化成电子材料有限公司	2013年6月12日	原始取得
2	一种环氧树脂和硅树脂固化涂层和封装的脱出剂	发明专利	谭晓华；冯亚凯	ZL201110269671.4	2011年9月13日	天津德高化成电子材料有限公司	2013年6月19日	原始取得
3	无味的半导体封装模具用清模和润模双功能材料	发明专利	谭晓华；冯亚凯；孙绪筠	ZL201210280108.1	2012年8月7日	天津德高化成电子材料有限公司	2014年3月19日	原始取得
4	基于有机与无机复合色彩转换膜的白色有机电	发明专利	吴晓明、华玉林、印寿	ZL200910069451.X	2009年6月26日	天津德高化成电子材料	2010年11月10日	继受取得

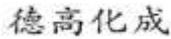
	致发光器件		根、徐力、 侯庆传、齐 青瑾		有限公司		
--	-------	--	----------------------	--	------	--	--

截至本公开转让说明书签署之日，国家知识产权局已受理公司的专利申请情况如下：

序号	名称	申请号	申请日	申请人
1	发光二极管封装用有机聚硅氧烷组合物	201410174179.2	2014年4月28日	天津德高化成电子材料有限公司
2	一种快速固化发光二极管灯丝封装胶及制备方法	201410173929.4	2014年4月28日	天津德高化成电子材料有限公司
3	用于指纹传感器的介电复合材料的制备方法	201410437851.2	2014年8月29日	天津德高化成新材料股份有限公司

## (2) 商标权

截至本公开转让说明书签署之日，公司注册商标情况如下：

序号	商标	注册人	有效期限	编号	类别
1		天津德高化成电子材料有限公司	2013年3月14日 -2023年3月13日	10397965	1
2		天津德高化成电子材料有限公司	2013年3月14日 -2023年3月13日	10397906	1
3		天津德高化成电子材料有限公司	2013年3月14日 -2023年3月13日	10399710	17
4		天津德高化成电子材料有限公司	2012年5月21日 -2022年5月20日	9433855	17

截至本公开转让说明书签署之日，国家工商总局商标局已受理公司的商标申请情况如下：

序号	商标	申请人	申请日期	申请号	类别
1		天津德高化成电子材料有限公司	2013年7月12日	12909737	4
2		天津德高化成电子材料有限公司	2013年7月12日	12910143	35
3		天津德高化成电子材料有限公司	2013年7月12日	12910031	17
4		天津德高化成电子材料有限公司	2013年7月12日	12909975	4

5		天津德高化成电子材料有限公司	2013年7月12日	12910337	35
6		天津德高化成电子材料有限公司	2013年7月12日	12909764	4
7		天津德高化成电子材料有限公司	2013年7月12日	12910241	35
8		天津德高化成电子材料有限公司	2013年10月16日	13376637	1

### (3) 著作权

截至本公开转让说明书签署之日,公司共有1项软件著作权,具体情况如下:

序号	软件名称	著作权人	证书号	开发完成日	首次发表日	取得方式	权利范围
1	德高化成新材料研发过程监控系统	天津德高化成电子材料有限公司	软著登字第0449671	2011年3月17日	2012年2月16日	原始取得	全部权利

### 3、无形资产账面价值

公司专利、商标等无形资产在形成过程中均进行了费用化处理,截至2014年5月31日,公司无形资产账面价值为0。

### (三) 业务许可及资质情况

#### 1、质量管理体系认证

2012年1月9日,方圆标志认证集团有限公司出具了质量管理体系认证证书,证明公司建立的管理体系符合GB/T 19001-2008、ISO 9001:2008标准要求,认证范围为半导体器件封装用清模及润模橡胶材料的设计、开发和制造,证书编号为00212Q10887R1S,有效期至2015年1月8日。

#### 2、高新技术企业证书

公司于2012年11月8日获得《高新技术企业证书》,有效期三年,证书编号为GR201212000248,批准单位:天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局。

#### 3、企业产品执行标准证书

2014年8月5日,天津市滨海新区质量技术监督局塘沽分局向公司核发了《企业产品执行标准证书》,证书代码为TG0946-2014,具体登记产品执行标准如下:

序号	产品名称	产品执行标准名称	执行标准编号
1	半导体芯片封装模具用清模橡胶	半导体芯片封装模具用清/润模橡胶	Q/12TG 4336-2014
2	半导体芯片封装模具用润模橡胶	半导体芯片封装模具用清/润模橡胶	Q/12TG 4336-2014

#### （四）特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司无特许经营权。

#### （五）固定资产

公司固定资产包括电子设备、运输工具、生产设备等。截至 2014 年 5 月 31 日，公司固定资产原值为 2,408,409.85 元，净值为 1,332,140.32 元，总体成新率为 55.31%，具体情况如下：

项目	原值（元）	累计折旧（元）	净值（元）	成新率（%）
电子设备	833,255.76	498,372.48	375,908.92	45.11
生产器具	752,547.75	305,799.84	490,764.99	65.21
生产设备	697,752.12	233,535.06	464,217.06	66.53
运输工具	124,935.22	123,685.87	1,249.35	1.00
合计	2,408,490.85	1,161,393.25	1,332,140.32	55.31

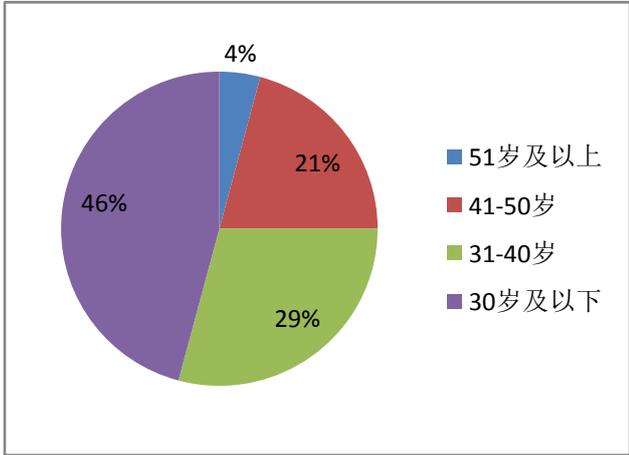
#### （六）公司人员构成及核心技术人员情况

##### 1、员工情况

截至 2014 年 5 月 31 日，公司共有员工 24 人，公司与全部员工均签订劳动合同。公司员工具体情况如下：

##### （1）按年龄分布

年龄	人数	比例
51 岁及以上	1	4.17%
41-50 岁	5	20.83%
31-40 岁	7	29.17%
30 岁及以下	11	45.83%
合计	24	100%



- 51岁及以上
- 41-50岁
- 31-40岁
- 30岁及以下

## (2) 按学历分布

学历	人数	比例
硕士研究生	5	20.83%
大学本科	12	50.00%
大学专科	2	8.34%
中专及高中	5	20.83%
合计	24	100.00%

Detailed description of the pie chart: The chart is divided into four segments. The largest segment is red, representing Bachelor's degree at 50%. The next largest is blue, representing Master's degree at 20.83%. The purple segment represents High school and vocational school at 20.83%. The smallest segment is green, representing University专科 at 8.34%.

## (3) 按专业划分

专业	人数	比例
生产	6	25.00%
销售	6	25.00%
研发	5	20.83%
管理	7	29.17%
合计	24	100.00%

Detailed description of the pie chart: The chart is divided into four segments. The largest segment is purple, representing Management at 29.17%. The next largest is blue, representing Production at 25.00%. The red segment represents Sales at 25.00%. The green segment represents R&D at 20.83%.

## 2、核心技术人员情况

公司核心技术人员为谭晓华、孙绪筠，公司核心技术人员的持股及任职情况如下：

序号	姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	任职
1	谭晓华	2,720,000	68	董事长、总经理
2	孙绪筠	80,000	2	董事、研发部负责人

公司核心技术人员基本情况参见本公开转让说明书“第一章 公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。

报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

## 四、公司的业务经营情况

### （一）业务收入情况

报告期内，公司的主营业务收入主要来自电子化学品材料销售，占销售收入98%以上，辅以少量技术咨询服务收入，其产品/劳务按类别分类的销售收入及占当期主营业务收入的比例如下表所示：

项目	2014年1-5月份		2013年度		2012年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
产品收入	3,608,641.54	98.96	11,450,027.65	98.20	6,134,930.74	99.57
咨询收入	37,805.52	1.04	210,077.90	1.80	26,688.20	0.43
合计	3,646,447.06	100.00	11,660,105.55	100.00	6,161,618.94	100.00

公司在高端芯片封装清润材料制造领域，已形成了丰富的技术、产品储备。目前，公司IC封装材料、LED封装材料已开始在国内先进封装测评企业上线评估，正式进入市场后，公司产品将进入国内外先进封装企业，营业收入将有进一步提升。

### （二）主要客户情况

报告期内，公司主要销售对象是集成电路、分立器件封装企业或代理商。目前，公司已拥有多家常年使用公司产品的半导体封装企业用户。报告期内，公司对主要客户的销售情况如下：

#### 1、2014年1-5月份

序号	客户名称	收入金额（元）	比例（%）	客户性质
1	上海旭福电子有限公司	1,089,871.73	29.89	最终用户
2	天津齐泰科技有限公司	366,788.91	10.06	代理商
3	凤凰半导体通信（苏州）有限公司	411,460.00	11.28	最终用户
4	无锡华润安盛科技有限公司	284,200.00	7.79	最终用户
5	苏州达顺鸿天电子科技有限公司	276,512.80	7.58	最终用户
	合计	2,428,833.44	66.61	

#### 2、2013年度

序号	客户名称	收入金额（元）	比例（%）	客户性质
1	天津齐泰科技有限公司	3,944,057.09	33.83	代理商

2	上海旭福电子有限公司	2,353,546.94	20.18	最终用户
3	凤凰半导体通信（苏州）有限公司	1,567,486.70	13.44	最终用户
4	东莞宽诚电子材料有限公司	923,076.83	7.92	代理商
5	上海持进电子科技有限公司	611,282.01	5.24	代理商
	合计	9,399,449.57	80.61	

### 3、2012 年度

序号	客户名称	收入金额（元）	比例（%）	客户性质
1	上海旭福电子有限公司	2,009,700.91	32.76	最终用户
2	天津齐泰科技有限公司	1,429,955.04	23.31	代理商
3	凤凰半导体通信（苏州）有限公司	874,112.38	14.25	最终用户
4	东莞宽诚电子材料有限公司	472,102.48	7.70	代理商
5	苏州达顺天明机电科技有限公司	334,358.98	5.45	最终用户
	合计	5,120,229.79	83.46	

报告期内，公司主要客户保持相对稳定，公司不存在对单一客户销售比例超过 50% 的情形。2014 年 1-5 月份、2013 年度、2012 年度，公司对前五大客户的销售收入占公司营业收入总额的比例分别为 66.61%、80.61%、83.46%，客户相对较为集中，主要由于公司设立时间不长，产品较为单一。公司设立前期主要从事清模润模材料的研发，目前公司销售收入中半导体封装清润模材料占据了绝对比重。报告期内，公司的客户集中度逐期下降，随着公司 IC 封装材料、LED 封装材料陆续打入市场，公司销售收入将发生大幅度提升，且对前五大客户的销售比例将继续下降。

同时，由于半导体行业的特殊性，一项原材料的改变都可能会对制造工艺或产品质量产生重大的变化，半导体企业通常倾向于和已有的供应商继续合作，而不会轻易改动。新供应商进入市场必须先经过用户严格的合格供应商认证，从而使新企业进入行业难度增大。严格的客户评估、认证制度及持续技术支持与服务也使得半导体材料及设备企业和下游客户之间形成紧密的合作关系，一旦成功进入其供应体系，就很难被替代。公司已通过上述客户（或客户的客户）严格的产品认证，并与该等客户已形成了稳定的供求关系，客户根据其生产计划向公司定期下发订单，公司根据订单独立组织材料采购、产品生产。

另外，公司前五大客户中，部分客户为公司产品经销商而非最终用户，公司由于产品的优良品质得到最终用户青睐，即使无中间经销商存在，产品最终用户亦会选用公司产品。

因此，公司对前五大客户不存在重大依赖。

其中，天津齐泰科技有限公司系公司关联方，其关联关系、关联交易具体情况见“第四章 财务部分”之“十、关联方、管理方关系及关联方交易情况”部分。除此之外，公司与其他客户不存在关联关系。

### （三）主要原材料供应情况

公司主要产品生产所需的原材料为橡胶、树脂、二氧化硅、氧化铝等化工材料。公司对主要原材料建立了稳定的供应体系，和主要供应商保持常年稳定的合作关系。报告期内，公司向主要供应商采购金额及占当期采购总额的比例如下：

#### 1、2014年1-5月份

序号	供应商名称	采购金额（元）	比例（%）
1	天津中荣胶业股份有限公司	151,837.60	25.49
2	上海门尼工贸有限公司	122,589.74	20.58
3	长兴电子材料（昆山）有限公司	65,128.20	10.93
4	上海资康贸易有限公司	47,863.25	8.04
5	广州市新烯冶金化工有限公司	35,897.44	6.03
	合计	423,316.23	71.06

#### 2、2013年度

序号	供应商名称	采购金额	比例（%）
1	天津齐泰科技有限公司	2,100,045.68	56.98
2	天津中荣胶业股份有限公司	460,683.76	12.50
3	上海门尼工贸有限公司	321,102.57	8.71
4	广州市新烯冶金化工有限公司	118,205.13	3.21
5	江苏康乐新材料科技有限公司	64,102.55	1.74
	合计	3,064,139.69	83.13

#### 3、2012年度

序号	供应商名称	采购金额（元）	比例（%）
----	-------	---------	-------

1	天津中荣胶业股份有限公司	447,777.79	32.09
2	长兴电子材料（昆山）有限公司	216,807.70	15.54
3	上海门尼工贸有限公司	170,153.84	12.19
4	广州市新烯冶金化工有限公司	41,782.04	2.99
5	上海资康贸易有限公司	15,384.61	1.10
	合计	891,905.98	63.91

报告期内，公司主要供应商相对稳定，公司不存在对单一供应商采购比例超过 50% 的情形。2014 年 1-5 月份、2013 年度、2012 年度，公司对前五大客户的销售收入占公司营业收入总额的比例分别为 71.06%、83.13%、63.91%，较为集中。但是，公司上游为化工或精细化工行业，公司所需原材料占市场份额较小，市场供应充足，公司对以上供应商不存在依赖。

除齐泰科技外，公司与上述供应商不存在关联关系。

#### （四）对持续经营有重大影响的合同及履行情况

##### 1、销售合同

标的金额在 10 万元以上的销售合同如下：

合同主体	合同标的	总价（元）	合同签订日期	总价（元）	履行状态
上海旭福电子有限公司	洗模胶条、润模胶条	209,249.98	2012 年 1 月 12 日	209,249.98	履行完毕
上海旭福电子有限公司	洗模胶条	169,949.99	2012 年 2 月 17 日	169,949.99	履行完毕
上海旭福电子有限公司	洗模胶条	113,299.99	2012 年 3 月 23 日	113,299.99	履行完毕
上海旭福电子有限公司	洗模胶条、润模胶条	265,899.98	2012 年 4 月 16 日	265,899.98	履行完毕
上海旭福电子有限公司	洗模胶条、润模胶条	202,699.98	2012 年 5 月 15 日	202,699.98	履行完毕
上海旭福电子有限公司	洗模胶条、润模胶条	259,349.98	2012 年 6 月 13 日	259,349.98	履行完毕
上海旭福电子有限公司	洗模胶条、润模胶条	305,199.99	2012 年 7 月 11 日	305,199.99	履行完毕
上海旭福电子有限公司	洗模胶条、润模胶条	209,249.98	2012 年 8 月 23 日	209,249.98	履行完毕

上海旭福电子有限公司	洗模胶条、润模胶条	202,699.98	2012年10月11日	202,699.98	履行完毕
上海旭福电子有限公司	洗模胶条、润模胶条	135,750.00	2012年12月12日	135,750.00	履行完毕
凤凰半导体通信(苏州)有限公司	洗模胶条、润模胶条	139,575.50	2012年10月5日	139,575.50	履行完毕
凤凰半导体通信(苏州)有限公司	洗模胶条、润模胶条	109,233.00	2012年12月7日	109,233.00	履行完毕
上海旭福电子有限公司	洗模胶条、润模胶条	199,399.99	2013年1月7日	199,399.99	履行完毕
上海旭福电子有限公司	洗模胶条	257,499.45	2013年2月5日	257,499.45	履行完毕
上海旭福电子有限公司	洗模胶条	169,949.99	2013年3月26日	169,949.99	履行完毕
上海旭福电子有限公司	洗模胶条、润模胶条	232,199.98	2013年4月17日	232,199.98	履行完毕
上海旭福电子有限公司	洗模胶条	226,599.98	2013年5月15日	226,599.98	履行完毕
上海旭福电子有限公司	洗模胶条	226,599.98	2013年6月28日	226,599.98	履行完毕
上海旭福电子有限公司	洗模胶条、润模胶条	302,899.98	2013年7月16日	302,899.98	履行完毕
上海旭福电子有限公司	洗模胶条、润模胶条	252,799.98	2013年8月6日	252,799.98	履行完毕
上海旭福电子有限公司	洗模胶条、润模胶条	252,799.98	2013年9月17日	252,799.98	履行完毕
上海旭福电子有限公司	洗模胶条、润模胶条	183,049.99	2013年10月18日	183,049.99	履行完毕
上海旭福电子有限公司	洗模胶条、润模胶条	256,349.98	2013年11月14日	256,349.98	履行完毕
上海旭福电子有限公司	洗模胶条、润模胶条	202,699.98	2013年12月16日	202,699.98	履行完毕
凤凰半导体通信(苏州)有限公司	橡胶清模条、橡胶脱模胶	145,644.00	2013年1月24日	145,644.00	履行完毕

凤凰半导体通信 (苏州)有限公司	橡胶清模条、 橡胶脱模胶	133,807.50	2013年3月6日	133,807.50	履行完毕
凤凰半导体通信 (苏州)有限公司	橡胶清模条、 橡胶脱模胶	118,940.00	2013年4月9日	118,940.00	履行完毕
凤凰半导体通信 (苏州)有限公司	橡胶清模条、 橡胶脱模胶	101,099.00	2013年5月7日	101,099.00	履行完毕
凤凰半导体通信 (苏州)有限公司	橡胶清模条、 橡胶脱模胶	123,697.60	2013年6月6日	123,697.60	履行完毕
天津齐泰科技有限 公司	橡胶清模条、 橡胶脱模胶	114,075.00	2013年2月1日	114,075.00	履行完毕
天津齐泰科技有限 公司	橡胶清模条、 橡胶脱模胶	116,972.75	2013年11月29 日	116,972.75	履行完毕
吴江巨丰电子有限 公司	橡胶清模条、 橡胶脱模胶	147,420.00	2013年9月16日	147,420.00	履行完毕
上海旭福电子有限 公司	洗模胶条、润 模胶条	252,799.98	2014年1月8日	252,799.98	履行完毕
上海旭福电子有限 公司	洗模胶条、润 模胶条	259,349.98	2014年1月22日	259,349.98	履行完毕
上海旭福电子有限 公司	洗模胶条、润 模胶条	202,699.98	2014年2月19日	202,699.98	履行完毕
上海旭福电子有限 公司	洗模胶条、润 模胶条	252,799.98	2014年4月3日	252,799.98	履行完毕
上海旭福电子有限 公司	洗模胶条	104,800.01	2014年4月16日	104,800.01	履行完毕
上海旭福电子有限 公司	洗模胶条、润 模胶条	318,299.99	2014年6月9日	318,299.99	履行完毕

## 2、采购合同

标的金额在 10 万元以上的采购合同如下：

合同主体	合同标的	签订日期	履行状态	总价（元）
天津齐泰科技有 限公司	EPT-1045	2012年8月12日	履行完毕	1,450,000.00
天津中荣胶业股 份有限公司	顺丁胶	2013年10月11日	履行完毕	154,000.00

中海油销售天津有限公司	顺丁胶	2014年8月13日	履行完毕	141,000.00
-------------	-----	------------	------	------------

### 3、房屋租赁合同

出租人	承租人	标的	金额	用途	租赁期限	履行状态
天津塘沽海洋高新区创业服务中心	公司	证号为津字第107010912113的2030.74平方米的房屋	20元/平方米/月	生产、研发、办公	2013年3月1日-2014年12月30日	在履行
夏文建	公司	坐落于上海市长宁区宣化路28号1506室的80.83平方米的房屋（沪长字2008第013017号）	11,000元/月	办公	2013年4月1日-2015年3月31日	在履行
上海平康物业管理有限公司	公司	坐落于上海市东张江哈雷路898弄6号楼418室的34.4平方米的实验室	9,125元/月	实验室	2014年1月1日-2014年12月31日	已解除

公司与以上房屋出租方关系良好，不存在续租障碍。

### 4、借款合同

贷款人	签订日期	金额	利率	期限	担保情况	履行情况
中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行	2012年11月27日	350万元	基准利率上浮15%	-	谭晓华提供房地产抵押（12100220120008917）、方玉辉提供房地产抵押（12100220120008918）、	已履行
谭晓华	2012年12月1日	100万元	6%/年	1年	无	已履行

注1：有限公司向中国农业银行的借款约定的总金额为350万元，约定的发放时间及借款期限如下：

借款金额	发放日期	借款期限
700,000.00	2012年12月14日	2012年12月14日-2013年11月26日
1,450,000.00	2013年9月9日	2013年9月9日-2013年11月26日

公司实际向银行借款总金额为2,150,000.00元，已按上述约定时间偿还完毕。

注2：公司向股东谭晓华借款实际向其支付利息3万元，谭晓华自愿放弃另

外 3 万元利息收益。

## 5、担保合同

抵押人	抵押权人	合同编号	抵押物	抵押物价值	担保范围
谭晓华	中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行	12100220120008917	房地证津字第 114021203148 号	157 万元	合同编号为 12010120120001079 的流动资金贷款合同项下 105 万元借款
方玉辉	中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行	12100220120008918	房地证津字第 114021004309 号	166 万元	合同编号为 12010120120001079 的流动资金贷款合同项下 110 万元借款

## 五、公司的商业模式

公司主要产品包括清模润模橡胶、IC 封装用 EMC 材料和 LED 封装材料，针对三中不同业务，公司分别有不同商业模式

### （一）清模润模橡胶商业模式

充分满足用户本地化采购的成本与服务需求、形成自有品牌的半导体封装材料进入行业的“开门产品”。

橡胶清润模材料是保证半导体塑封用户定期清理润滑模具的过程辅助材料，即配合 EMC 封装树脂使用的先头部队。该市场一直被日本、韩国、东南亚厂商垄断。德高化成以技术创新、国内生产加工、国内品牌营销为号召力和竞争力实现进口替代。该产品通过代理商及直接用户的销售，奠定了德高化成品牌进入以供应商认证系统严密著称的半导体封装行业。橡胶清润模产品作为“开门产品”把握住了终端用户入口，为公司发展 EMC 材料铺平了道路。再有该产品较高的毛利率也支撑了公司向新业务模块的研发投入。

### （二）EMC 材料商业模式

集中优势资源开发未来一代基于移动和穿戴设备的半导体器件封装材料、以 OEM 方式与传统 EMC 制造商联盟获得其生产加工资源并共享其销售渠道，革命性降低制造成本及营业成本，实现具备“快速市场投放能力”的新材料产业化模式。

EMC 即半导体封装用环氧树脂塑封料，是封装行业的“粮食”。该行业已形成日本两家巨头助友、日立占据技术及利润高端，而国内厂商不得不以规模化的

低利润产品占据低端的两极分化状态。目前,国内 EMC 厂商产能利用率仅 40-50% 左右,并缺乏高端产品的开发经验与生产管理能力。此外移动互联及穿戴设备形成的新一波半导体器件的设计革命催动着半导体封装器件向更薄、更小、更快速、模组化、传感器化等极致方向发展,随之而来是更多对 EMC 的可靠性、功能性的诸多客户定制类新技术要求。公司 EMC 团队具备强大的客户需求理解能力以及新材料开发和生产工艺管理能力,公司在专注市场及研发两个高利润附加值的产业链条上,把 EMC 制造通过产业联盟方式委托出去,免去了重资产投入对公司投资能力及管理资源的消耗。同时国内 EMC 业者大都期望提升产品能力、工艺管理经验、共享高端客户资源,竞争对手可以形成合作共赢得战略联盟。

EMC 生产流程包括①原料前处理、②原料均相混合、③原料挤出混炼、④ B-stage 材料速冷及粉碎、⑤粉料再均相混合、⑥粉料打饼,其中③-⑥项是重资产生产过程。德高化成将与配方保密有关的①与②过程保留内作,其后流程委托生产,可实现既确保技术机密又开放合作的生产模式。目前,公司已与行业内优秀的两家企业达成了合作意向,并锁定了加工成本,使公司产品同时具备了高端低价的竞争优势。

### (三) LED 封装材料商业模式

LCD 背光及绿色半导体照明用白光 LED 封装行业一直以有机硅封装硅胶混合荧光粉点胶到蓝光芯片上,激发白光称为白光芯片。白光 LED 行业一般以芯片厂(蓝宝石外延)、封装厂、灯具厂及配套的封装材料(硅胶、荧光粉)构成上下游关系。LED 封装企业的重要制程即控制硅胶与荧光粉的配合比例、混合方法、点胶工艺并避免荧光粉在硅胶中的分散不均、下沉、凝聚导致的光效不良。由于硅胶和荧光粉系外部采购,且批次均一度难以控制,LED 封装厂在封装完成后要对 LED 色温进行测试,并将色温有差异的芯片降级处理,这是 LED 行业的用户痛点。公司进入封装硅胶制造业界以来,没有盲目的发展通用型硅胶产品,因为这一行业在中国无一例外的产能过剩,价格红海竞争无涯。2013 年公司以高触变即点即成型的 OPSIL4702 灯丝专用封装硅胶进入绿色照明 LED 的新兴细分市场,奠定了公司朝“站得住”的胶水方向研发材料技术。

## 六、公司所处的行业情况

### （一）公司所处行业概况

#### 1、公司所处行业分类

公司产品主要为半导体产品配套，属于电子信息与化工行业交叉形成的电子化学品行业。从生产工艺看，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属的电子化学品行业为“化学原料及化学制品制造业”（C26）。

从公司细分产品的应用领域看，全球半导体产业主要由设计、半导体制造、半导体封装三个部分构成，公司产品主要用于半导体封装、制造领域，是新型的半导体工艺化学品材料，属于半导体制造和封装的支撑产业。公司所处行业的市场需求、技术发展体现出明显的半导体行业属性。

#### 2、行业管理体制、主要产业政策及相关法律法规

##### （1）行业管理体制

公司所处行业已实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，行业管理体制为国家宏观指导下的市场调节管理体制，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

公司行业的主管部门是国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部以及地方各级人民政府相应的行政管理职能部门。国家各级政府制定行业的产业政策和产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控。中国半导体行业协会是半导体行业的自律和服务机构。

##### （2）主要产业政策

近年来，我国推出了一系列鼓励半导体封装用电子化学品相关的行业政策。

主要政策	发布时间	发布部门	主要内容
产业结构调整指导目录（2005年本）	2005年12月	国家发改委	鼓励类：电子专用材料制造、专用精细化学品生产、高技术绿色电池产品制造、新型电子元器件制造
信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要	2006年8月	信息产业部	重点发展与元器件性能密切相关的半导体材料在电子装备及元器件中的用于支撑、装联和封装等实用的金属材料、非金属材料、高分子材料及各种复合材料等。
国务院关于加	2010年10月	国务院	现阶段重点培育和发展节能环保、新一

快培育和发展战略性新兴产业的决定			代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。
国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知	2011年1月	国务院	为完善集成电路产业链,对符合条件的集成电路封装、测试、关键专用材料企业以及集成电路专用设备相关企业给予企业所得税优惠。
国民经济和社会发展规划第十二个五年规划纲要	2011年3月	十一届人大四次会议	大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。新一代信息技术产业重点发展新一代移动通信、下一代互联网、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器和信息服务。新材料产业重点发展新型功能材料、现金结构材料、高性能纤维及其复合材料、共性基础材料。
当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)	2011年6月	国家发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局	优先发展的重点领域包括:高分子材料及新型催化剂、复合材料、环境友好材料。
集成电路产业“十二五”发展规划	2011年12月	工业和信息化部	加强新设备、新仪器、新材料的开发,形成成套工艺,推动国产装备在生产线上规模应用。
新材料产业“十二五”发展规划	2012年1月	工业和信息化部	突破超薄软磁非晶带材工程化制备技术,加快高频覆铜板材料、BT树脂、电子级环氧树脂、电子铜箔、光纤预制棒、特种光纤、通信级塑料光纤、高性能磁性材料、高频多功能压电陶瓷材料等新型元器件材料研发和产业化步伐。
新材料产业“十二五”重点产品目录	2012年1月	工业和信息化部	包括:特种橡胶、有机硅材料

### (3) 相关法律法规

电子化学品涉及的行业法律法规主要是《电子信息产品污染控制管理办法》,该办法自2007年3月1日起施行,要求“控制和减少电子信息产品废弃后对环境造成的污染,促进生产和销售低污染电子信息产品”。

综上，公司处于产业政策及法律法规优先发展和重点鼓励的行业，政策的主要导向为突破半导体行业中材料、设备和工艺的关键技术，提高国内自主配套能力，降低成本，为电子信息产业的发展提供有力支撑。同时，加快无污染、无公害、绿色环保型电子材料也是重要的政策导向。

### 3、电子化学品行业的发展状况

根据相关公开研究资料，全球电子化学品快速发展、高度垄断。2010年全球电子化学品产值约348亿美元，预计未来几年仍将维持6%-7%的增速，远高于全球GDP增速；电子化学品行业技术壁垒较高，生产集中于美、日、欧少数大企业，全球竞争格局相对稳定。国内优势企业的竞争力正在不断增强，成长空间巨大。“十一五”期间，我国电子化学品的年均增长率超过了20%，保守估计2015年将达到400-450亿元。巨大的市场需求为我国电子化学品产业的发展提供了机遇。2013年我国电子化学品年产值超过300亿元，总体技术水平达到了上世纪90年代末和本世纪初的国际先进水平；国内电子化学品供不应求，需求50%依赖进口，是国内化工行业中发展速度最快，最具活力的行业之一，属于国家战略性新兴产业的范畴。

### 4、我国电子化学品行业的主要特点

电子化学品作为精细化工和电子信息的交叉行业，其行业特点充分体现了两大行业的特点：

一是品种多、子行业多。电子化学品品种规格繁多，据不完全统计，产品品种在2万余种以上，在电子产品的不同领域中均有所应用，如手机、计算机、电脑、新能源电池等所使用的光刻胶、封装材料、高纯试剂、工艺化学品、液晶材料、电池正负极材料、电解液等多个子行业。

二是专业跨度大、技术门槛高。电子化学品系化学、化工、材料科学、电子工程等多学科结合的综合学科领域，单一产品具有高度专用型，应用领域集中，各种电子化学品之间在材料属性、生产工艺、功能原理、应用领域之间差异较大，产品之间专业跨度大。

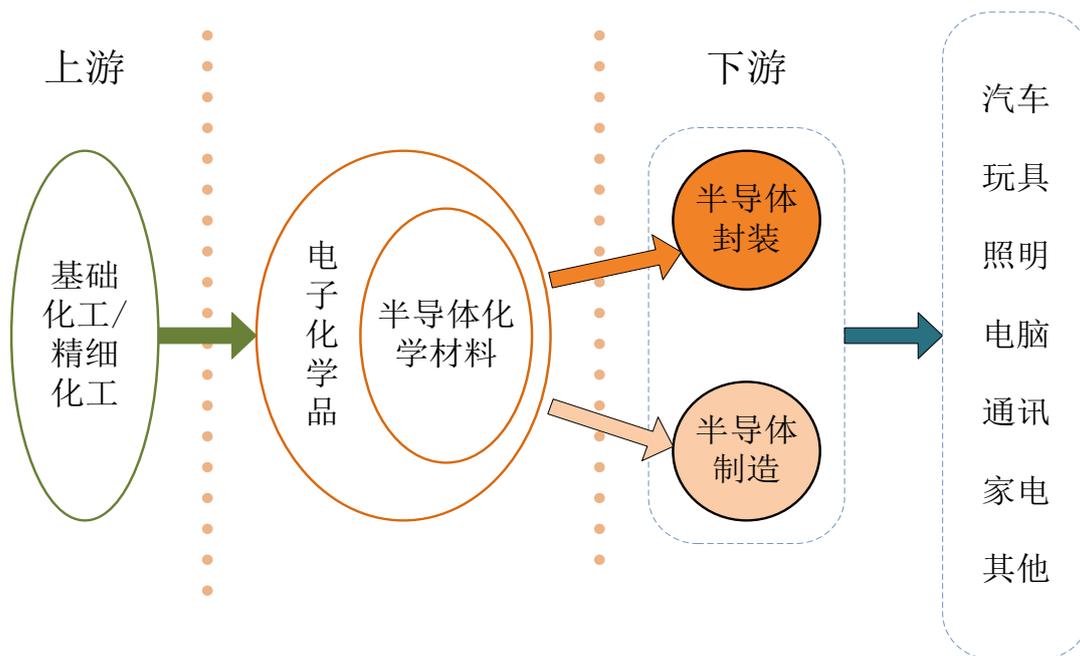
三是产品更新换代快。电子化学品与下游行业结合紧密，新能源、信息通讯、消费电子等下游行业的快速发展，势必要求电子化学品更新换代速度不断加快，企业科技研发水平与日俱增。素有“一代材料、一代产品”之说。

四是功能性强、附加值高。电子化学品是电子产业链的前端，其工艺水平和产品质量直接对元器件的功能构成重要影响，进而通过产业传导影响到终端整机产品的性能。元器件乃至整机产品的升级换代，有赖于电子化学品的技术创新和进步；电子化学品功能的重要性决定了产品附加值较高、质量要求严的特点。

五是与下游企业关系紧密。电子化学品尽管在下游电子元器件中成本占比很小，但对最终产品性能影响很大，大型下游企业对原料的质量和供货能力十分重视，常采用认证采购的模式。一般产品得到下游客户的认证需要较长的时间，因此一旦与下游企业合作，就将形成稳定的合作关系，后进入市场者面临较高的市场门槛。

六是龙头企业市场占有率较高。以上五点决定了电子化学品细分行业市场集中度较高，龙头企业市场份额较大。

### 5、电子化学品行业上下游产业及其关联性



公司主要从上游基础化工或精细化工材料行业采购化工产品，用于半导体封装过程材料和结构材料所需的电子化学品的研发、生产等。

公司电子化学品主要为下游半导体制造与封装企业服务，最终产品为消费电子、家用电器、信息通讯、航空航天等整机产品，广泛应用于国民经济和国防建设的诸多领域。公司向客户提供的绝大多数化学材料都是针对行业甚至使用现场研发的专用化学品，根据行业和客户的技术变化不断改进、不断升级，公司和行业、客户保持着长期互动关系。一方面公司产品得以不断改进和丰富，另一方面

公司与客户的关系更加紧密和牢固。

公司上游为化工行业，公司所需原材料占市场份额较小，市场供应充足；市场波动主要影响的是公司的采购成本，公司产品毛利率水平较高，上游市场变化对公司影响较小。

下游半导体及信息产业和半导体化学材料行业在发展上存在较强的互相带动和互相依存关系。一方面，下游信息产业终端产品日新月异的多样化需求，如便携性、低耗性、多功能、智能化的要求，对半导体产业和半导体材料业持续提出新的技术和材料需求，促进其技术创新；另一方面，下游半导体及信息产业的发展，将带动半导体化学材料的市场需求。此外，电子化学品的性能和质量也直接影响到电子产品质量，甚至影响微电子制造技术的产业化，在一定程度上制约着下游半导体产业及信息产业的技术升级。

近年来，在国内半导体产业高速增长的拉动下，我国半导体行业所需的电子化学品行业取得了长足进步；与持续高速增长的集成电路产业相比，相关电子化学品的技术水平和产业规模均较小，自给率仍较低。尤其先进封装和芯片制造配套的支撑产业——半导体材料业的技术水平和产业规模发展滞后，对国内半导体相关产业发展的制约作用仍然十分明显。如高性能的电子化学品仍主要依赖进口，难以满足国内半导体产业的技术升级和市场规模持续发展的要求。

未来，半导体及电子信息产业作为国家的战略性基础产业，将长期受益于国家产业政策支持、全球产能向国内转移、国内 4G、物联网等新技术应用以及国内庞大的终端产品消费市场持续增长等有利因素，从而为半导体新型化学材料带来较大的发展机遇。在国家建设独立、自主、可控产业链，鼓励国内半导体材料国产化的政策导向下，本土半导体材料企业产品技术水平和品质，一旦达到国外同等水平就会面临广阔的发展空间。

## 6、行业的周期性、季节性、区域性特征

### （1）周期性

受国际芯片发展准则——摩尔定律的制约，半导体产业的发展会有波动，具有技术呈周期性发展和市场呈周期性波动的特点。因此，一般认为半导体行业是周期性行业，并且市场规模在总体上呈现随着国民经济发展而不断上升的趋势。

本公司从产品应用领域看，属于半导体产业的支撑产业，行业发展周期与半

导体产业一致。

## （2）季节性

消费电子、家用电器、信息通讯等民用消费品是半导体行业的主要终端产品，在节假日期间全球市场销量也会比平时大幅增加。而全年的节假日，除了五一，其余如十一、元旦、春节、包括国外的圣诞节都在下半年，故下半年日常的电子产品销量会高于上半年。同时，下游客户多在年末或年初确定投资项目增产计划，并多在下半年实现大批量投产。

从行业季节性特点来看，正常情况下，半导体行业季节性特征通常表现在上半年略显淡季，下半年略显旺季。

## （3）区域性

从全球区域性看，因为半导体产能继续向亚太地区转移，亚太地区仍是增长速度最快的地区，其中我国大陆集成电路市场持续快速增长起了主要作用。从国内看，目前国内的半导体产业主要集中在长江三角洲地区、京津环渤海地区和珠江三角洲地区，其中长江三角洲地区的半导体产量就占全国半导体产量的一半。

半导体行业所需的电子化学品也随着产业转移和国内企业的技术进步呈现本土供应的趋势，这也是国内材料支撑业的发展机遇。

## （二）细分行业市场规模及未来前景

### 1、清模润模材料领域

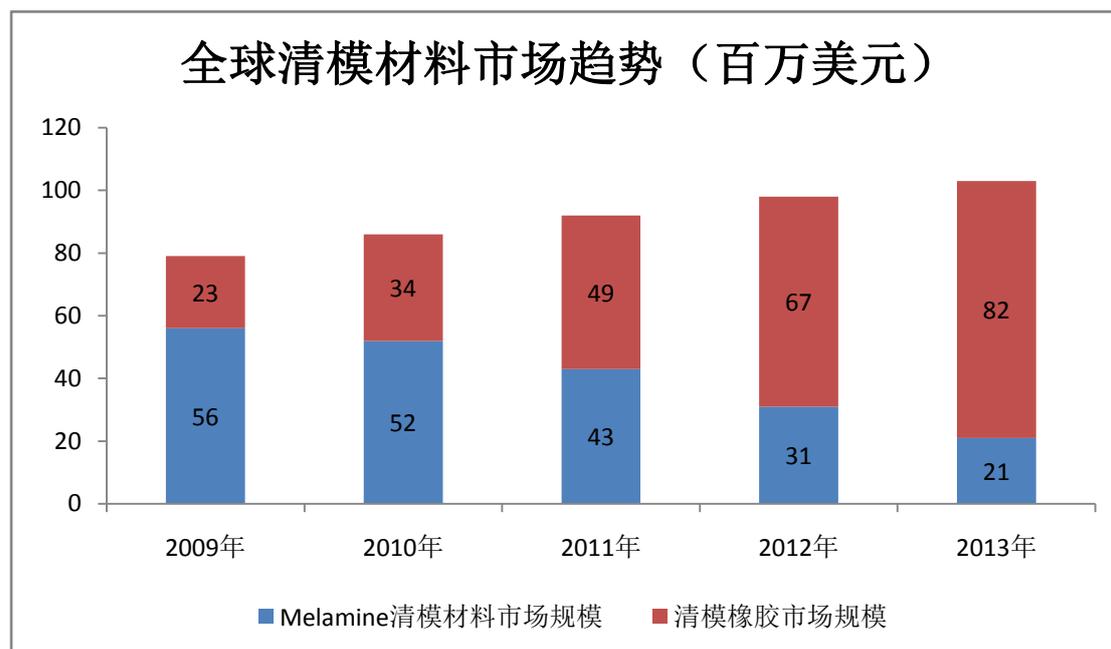
目前，传统的半导体塑封膜用清润功能化材料一般采用以下组合，即清模材料使用马来酸酐-酚醛树脂（简称“Melamine 树脂”），润模材料使用有机溶剂喷蜡气雾剂（简称“喷蜡”）。Melamine 树脂的主要缺点是：①操作性差，需针对不同模具提供尺寸繁多的产品，造成采购及库存管理困难；②经济性差，须配合使用金属铜支架；③环保性差，固化分解产生甲醛等有害气体。喷蜡材料的主要缺点是：①稳定性差，人工喷蜡无法保证涂覆的均一性；②适用性差，当前成熟的喷蜡产品提供的蜡种类有限，无法满足不同封装树脂的脱模需求；③环保性差，溶解蜡的有机溶剂，特别是氟氯烃类和甲苯类对环境有害。

随着环保环氧树脂替代普通的塑封料，需增加清模频次，使得从业者更有动力和压力降传统的 Melamine 清模材料换成橡胶清模材料，以缩短清模时间，提高生产效率。

铜材价格的上涨也导致 Melamine 清模材料对橡胶清模材料让出市场。因为，Melamine 清模材料必须搭配铜引线框架一起使用。所以，铜材价格的上涨，使得单价更为昂贵的橡胶清模材料具有了综合成本优势。

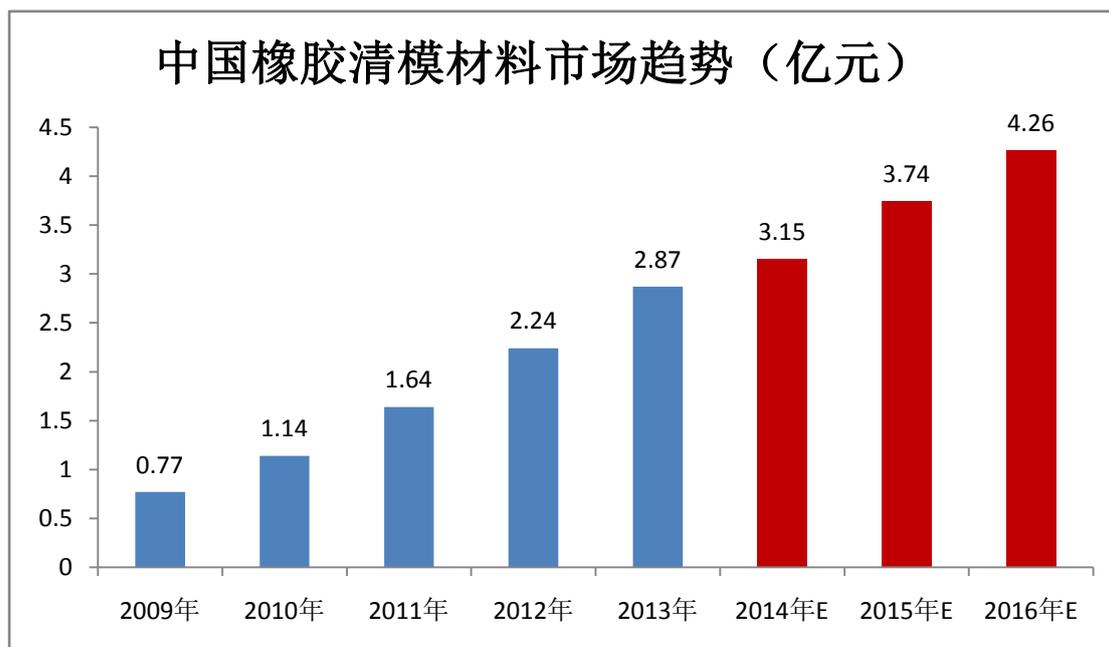
半导体封装业的竞争加剧催化了橡胶材料的高速成长。从 2008 年开始，全球半导体封装业大肆投资厂房、设备，开始高速产能扩张。根据 SEMI 研究数据，从 2008 年到 2012 年的五年间，全球半导体封装测试产能年增长率超过 15%。然而，同期市场的增长率约为 7-8%。目前，全球半导体封装业已产能过剩，从而导致封装业者之间的竞争加剧。而成本和效率成为市场竞争决胜的关键，橡胶清模材料的采用则成为提高效率的必然选择。

随着半导体封装业对环保和效率的要求提高，在清模材料市场，橡胶材料在逐步取代 Melamine 的传统市场地位。自 2005 年起，清模材料的市场年增长率超过 7%，但是 Melamine 的市场仍旧逐步萎缩，而与之相反，清模橡胶的市场规模一直以 40% 的速度增长。



数据来源：德高化成研究

半导体封装测试业从欧美、日本乃至东南亚向中国大陆转移，目前中国大陆封装测试市场占据整个全球市场半壁江山。2011 年，半导体清模材料的中国大陆市场容量约为 3 亿人民币，其中橡胶清模材料占 1.6 亿人民币。到 2014 年，随着中国在半导体产业链比重的扩大，国内橡胶清模材料会进一步扩大到 3 亿人民币。



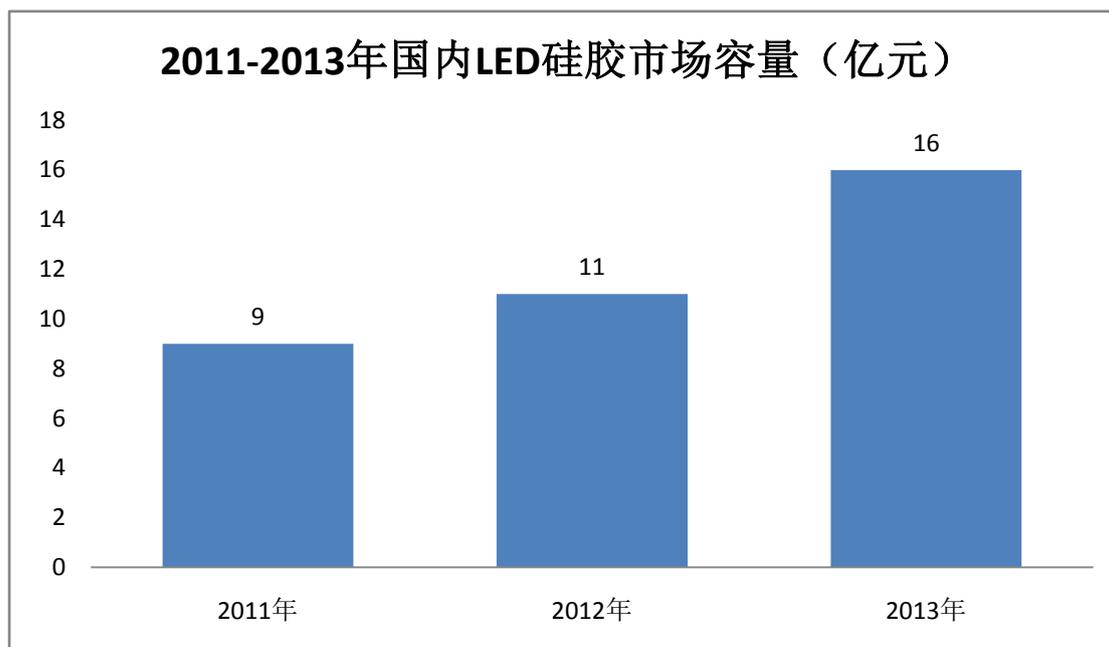
数据来源：德高化成市场研究

目前，在国际以及国内市场生产和销售橡胶清模材料的厂商有日本 NITTO DENKO、新加坡 IC VISION、韩国 NARA CHEM、韩国 Samsung、德国汉高等。作为结合了高分子合成技术、清洗技术和半导体应用技术等三个方面的橡胶清模产品，具有相当高的技术门槛，公司已取得一定的技术优势，并建立了较好的客户信任度和市场声誉。

## 2、LED 封装材料领域

LED 封装、灌封材料（Silicone Encapsulant）是用于 LED 封装的硅胶材料，广泛的用于外封和荧光粉配胶。LED 硅胶产品的基本结构单元是由硅-氧链节构成的，侧链则通过硅原子与其他各种有机基团相连。因此，在大功率 LED 硅胶产品的结构中既含有“有机基团”，又含有“无机结构”，这种特殊的组成和分子结构使它集有机物的特性与无机物的功能于一身，具有耐候、电气绝缘、生理惰性等突出性能。

LED 硅胶的市场需求，随着 LED 照明市场的普及和增长。2010 年以前，国内 LED 硅胶主要以进口为主，2011 年 LED 硅胶随之呈“井喷式”增长。根据市场调研机构高工 LED 统计，2013 年 LED 应用的市场产值达到了 2,068 亿人民币，其中 LED 硅胶 2013 年的市场产值在 16 亿人民币。其中，国产硅胶市场份额占到了 60% 以上。



数据来源：高工 LED 资讯网

尽管国内 LED 硅胶市场容量不断增加，但 LED 硅胶产品从 2011 年到 2014 年价格下跌 40%以上，国产从业者基本以较低利润运营。LED 硅胶供应商只有在细分市场做专做精，才能维持产品的合理利润空间。

美国道康宁公司、日本信越化学工业株式会社等国际大公司，均暂未有明确产品推出。主要原因是 LED 灯丝封装企业基本分布在中国大陆，并其主要的产品方向在普通 LED 照明市场，与上述公司市场定位不符。

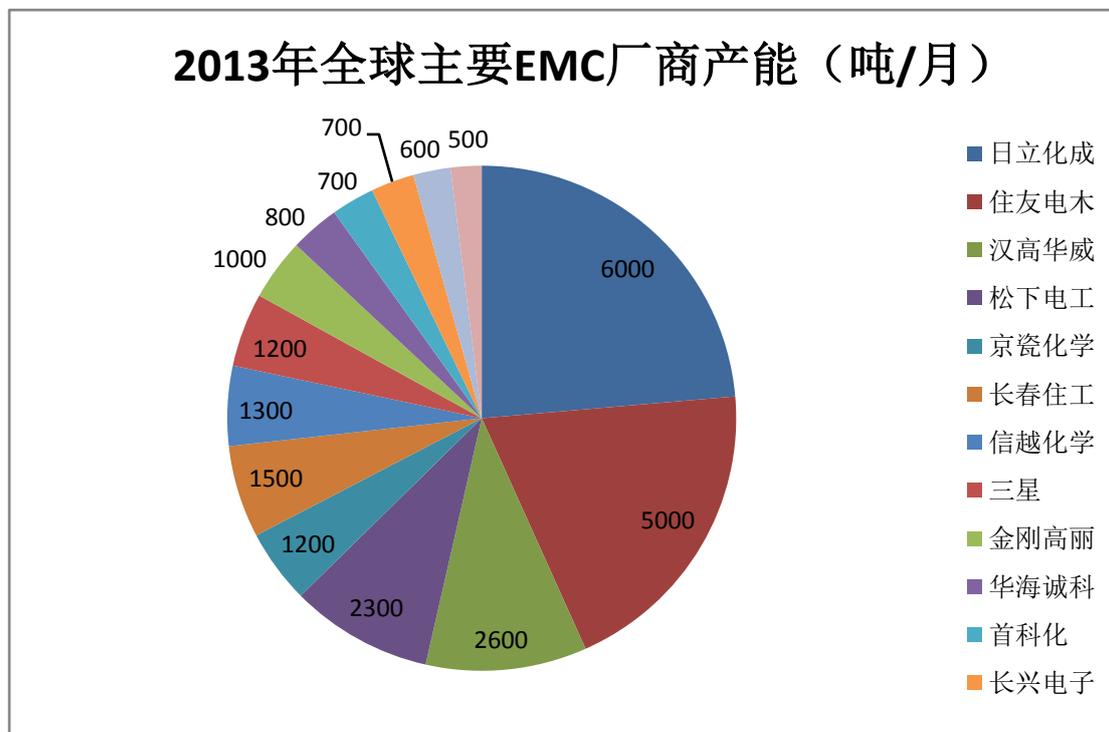
北京康美特科技有限公司，其主要的产品路线亦在普通 LED 照明市场。并未专门针对此细分市场开发新产品对应。

目前，在国内 LED 灯丝胶领域，三油兴业株式会社（日本）占有 60%以上份额，广州爱易迪新材料科技有限公司、易德展应用材料股份有限公司等占有 10%左右份额。

### 3、IC 封装材料领域

环氧树脂塑封料 EMC 是 IC 集成电路以及分立半导体器件应用最为广泛的封装材料。其高分子骨架体系采用邻甲酚醛环氧树脂、双环戊二苯酚环氧树脂、联苯型或者多官能团型环氧树脂与线性酚醛树脂在高温高压下发生交联反应实现固型目的，同时加入 60-80%的结晶型和熔融型二氧化硅微粉作为填料，以及少量的催化剂、偶联剂、低应力剂、离子捕捉剂等以改善其物理化学性能以满足半导体器件的耐焊性和可靠性要求。

EMC 的市场需求自 2003-2013 年的十年间总体处于平稳发展的趋势。全行业整体属于供大于求的状态，据市场调研机构 Prismark 估计，2013 年全球半导体行业的 EMC 消耗量约为 12 万吨，而同期全球主要 14 家厂商的 EMC 总生产能力为 30 万吨。



数据来源：德高化成市场研究

住友电木（Sumitomo Bakelite）和日立化成（Hitachi Chemical）长期占据价值链的顶端，参与全球竞争。该二公司出货数量占全球的 4 成，销售额占到 6 成，其 EMC 产品均价在 US\$10-13/kg。

其余三星、松下、京瓷、信越、KCC 等韩日系厂商参与国际区域竞争，依靠产品特色取胜。其出货数量占全球 3 成，销售额亦占 3 成，其 EMC 产品均价约 US\$7-9/kg。

中低端的 EMC 主要为国内厂商占据，主要的供应者有：汉高华威（原中电华威，于 2005 年被汉高 Henkel 收购）、长春住工（台湾长春化工与住友的合资公司）、长兴化学、首科化、中鹏新材、华海诚科、中新泰合等。主要依托中国市场，出货数量占全球 3 成，销售额占 1 成，其 EMC 产品均价为 4-6US\$/kg。

中高端的 EMC 仍然蕴含着巨大的市场机会。首先，至 2013 年中国对 EMC 的年需求量达 6 万吨，约占全球市场的 50%，其中中高端的 EMC 在 2 万吨以上。

中国市场对于中高端 EMC 的需求量巨大而且仍然在持续的增长之中。其次，虽然国内在过去的 7-9 年中进入 EMC 行业的厂商和资本数量急剧的增长，但是仍然集中在中低端的市场，而鲜有进入中高端市场者。

### （三）进入行业的主要壁垒

#### 1、技术壁垒

半导体领域电子化学品的研发，属于化学、电化学、化工、纳米材料、半导体、电子工程等诸多学科交叉融合的综合领域，专业性强，是典型的技术密集行业。

就产品特性看，应用于半导体领域的电子化学品，多为高性能、高可靠性、高纯度的配方类化学品，其研发及产业化应用需要解决一系列原料提纯、金属杂质颗粒及有机物含量控制、痕量分析检验方法、添加剂功能组分作用机理及其合成、生产工艺控制、包装物流等诸多难题，对企业的研发能力提出非常高的要求。一种电子化学品配方及应用工艺开发，往往需要在长期基础研究、实验数据、经验积累的基础上才能完成。已掌握核心技术的企业为保持竞争优势，采取各种措施保护其知识产权，对新进入企业造成了短期内难以克服的技术壁垒。

#### 2、人才壁垒

半导体领域所需的电子化学品及专用设备研发及应用技术需要化学、电化学、工程化学、纳米材料、电气自动化、电子工程等多学科综合知识的复合型人才和经验丰富、熟悉产品应用工艺的现场技术服务工程师。

目前国内缺乏有针对性的人才培养机构，此类人才极为短缺。要打造一支优秀、高水平、经验丰富的复合型技术与管理团队需要具备一定的社会资源和时间积累，因此先发企业的人才优势比较明显，新进者面临较高的人才壁垒。

#### 3、市场壁垒

在半导体领域中，一项原材料的改变都可能会对制造工艺或产品质量产生重大的变化，半导体企业通常倾向于和已有的供应商继续合作，而不会轻易改动，新的供应商难以在短期内进入市场。新供应商进入市场必须先经过用户严格的合格供应商认证，通常需要经历样品认证、现场审核、小批试产、批量生产等阶段，认证周期长，加上客户还会对相关售后服务和产品持续完善能力加以考察，从而使新企业进入行业难度增大。

严格的客户评估、认证制度及持续技术支持与服务也使得半导体材料及设备企业和下游客户之间形成紧密的合作关系，一旦成功进入其供应体系，就很难被替代。因此在细分行业的市场领域很容易形成一家龙头企业占据大部分市场份额的情况。龙头企业在销售网络、品牌、客户基础方面的竞争优势，使得其他潜在竞争对手短期内难以进入，构成市场壁垒。

## （七）影响电子化学品行业发展的有利因素和不利因素

### 1、有利因素

#### （1）国家产业政策支持

半导体产业是我国电子信息产业的基础性核心产业。由于不掌握核心技术，国内半导体产业发展面临整体技术水平低，高端集成电路制造装备、工艺、新材料主要依赖进口。半导体产业链不合理的局面不利于国内电子信息产业的机构调整和技术升级，不利于国民经济的发展和国家安全。

2009年，国家启动“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”（国家02重大科技专项），旨在开发集成电路关键制造装备，掌握具有自主知识产权的成套先进工艺及相关新材料技术，打破高端集成电路制造装备与工艺主要依赖进口的状况，提高我国半导体产业链的完整性。2010年9月，国务院常务会议审议并通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，新一代信息技术、新材料等七个产业被作为中国战略性新兴产业，将在今后加快发展。

#### （2）国内半导体产业市场需求旺盛

以集成电路为代表的半导体产业是电子信息高新技术产业的核心，是信息化带动工业化、加快传统产业机构优化升级的关键技术和信息社会发展基石，是世界高科技竞争的制高点之一。作为全球最大的电子整机制造基地，我国集成电路市场潜力巨大。

目前，我国半导体产业仍处于产业生命周期的成长期，在未来5至10年内，仍然保持着规模继续扩大，技术快速提升，产品不断更新的发展趋势。在未来几年中，我国电子信息产业将持续发展，国家继续振兴电子信息产品，实施工业化和信息化融合战略，并进一步采取家电下乡、启动4G通信的措施，大大扩展了我国半导体产业的市场空间。随着下一轮电子信息产品应用高潮的到来，下游产品的持续更新和升级，智能手机、平板电脑、数字电视、汽车电子、信息安全、

个人医疗电子、物联网、三网合一等成为半导体产业发展的动力，并带动相关的材料、设备产业的发展。

### （3）产能转移为国内本土企业提供了发展机遇

近年来国内已成为全球重要的半导体产业基地，同时电子信息产品市场需求巨大，高端芯片供需矛盾突出。国内在劳动力、技术人才、土地、资本等生产要素方面仍拥有优势，全球半导体制造和封装产能继续向国内转移，国内半导体产业将长期受益于承接国外产能的发展机遇。

受全球金融危机影响，全球主要半导体企业经历产业衰退后，整合重组和产业布局调整的速度加快。国内对半导体产业制定了多项优惠政策，在国家扩大内需、促进经济结构调整和产业升级的政策背景下，国内半导体市场巨大，低成本的劳动力资源丰富，外资、台资企业向国内转移芯片制造和封测产能的意愿继续增强，产能转移的速度将进一步加快。

全球半导体产能继续向国内转移，有利于满足国内多样化的市场需求，有利于国内半导体产业的技术升级，优化国内半导体产业结构，扩大了国内半导体支撑产业，材料和设备制造业的市场规模，为国内本土半导体材料企业带来良好机遇。

### （4）国内半导体企业产能不断扩张

2010年以来，随着全球及国内半导体产业的快速复苏，国内半导体企业受益于承接全球产能转移，纷纷启动了产能扩充计划。在高端芯片制造领域，中芯国际等国内代表芯片制造企业加大了资本支出和产能提升力度，同时上海华力等新的12英寸FAB厂也在积极筹建，德州仪器（TI）、和舰科技、台积电等外资芯片制造企业看好国内庞大的市场需求，全球产业布局向国内倾斜。在半导体封装领域，长电科技、通富微电、华天科技、佛山蓝箭等知名半导体封装材料均已公开了其产能扩充计划。

下游半导体产业的产能扩充，将直接带动封装清润模材料、LED封装胶、IC封装材料等本土化电子化学品市场需求的增長。

### （5）替代进口

目前，在半导体封装材料领域，高端半导体清润模材料、LED封装灌封胶、IC封装材料等产品，外资企业仍占据较高的市场份额，大部分产品依赖进口，成

本高、交货周期长。国内材料供应商的产品各项经济技术指标若能达到国外材料设备同等或更高的水平，将被优先采用，市场前景广阔。

## 2、不利因素

国内电子化学品产业技术水平与国外技术水平相比仍有较大的差距，高端产品少，中低档产品虽多，欠缺系统化且产品结构不合理，难以适应半导体产业市场快速发展的需要。国内先进封装所需的电子化学品的市场份额主要被国外企业占据，在半导体行业严格的供应商认证制度下，国内本土电子化学品企业的研发和市场开拓均面临较高的壁垒。

此外，国内在相关电子化学品领域的前瞻性研究较少，相关研发平台建设不完善，高水平的研发人才缺乏，本土企业综合实力相对较弱，也制约了行业的技术创新。

### （八）公司在行业中的竞争地位

#### 1、行业的竞争情况

国内半导体封装材料骨干企业规模小、经济实力弱、研发投入不足，自主创立能力不足，低水平竞争、重复建设、产能过剩等问题较为突出；产品还主要是低档产品为主，大量高技术含量、高附加值产品需从国外进口。以 EMC 材料为例，从全球范围来看，行业集中度较高，前五大 EMC 厂商（住友电木、日立化成、汉高华威、长春住工、三星）占据七成以上市场份额；国内厂商数量众多，产能过剩问题严重。从技术含量来讲，国内厂商主要从事低端 EMC 的生产，其产品主要应用于分立器件的封装；国外行业巨头主要从事高端集成电路封装材料。从产品单价来讲，国内企业依靠低成本、低价格参与市场竞争，出货量占全球三成，但销售额却不足一成；而住友电木和日立化成双巨头在全球出货量不足四成，但销售额却在六成以上。

#### 2、公司的竞争优势

##### （1）自主创新能力强

公司是以技术为主导的高新技术企业，不断通过新产品以及老产品的升级研发实现持续发展，拥有较强的自主创新能力。公司专业致力于半导体封装用电子化学品的研发、生产、销售及相关配套服务，经过多年积累，在半导体封装清润材料、LED 封装灌封材料、IC 封装材料等领域形成了丰富的产品体系和技术储备，

并获得多项国家发明专利。公司目前向市场销售产品、提供技术均为自主研发。

公司核心产品获得多项科技成果奖项并取得多项创新荣誉资质，技术水平达到行业内较高水平，并可替代进口产品。

### （2）人才优势

公司通过外部引进和内部培养相结合的方式，在半导体化学材料领域建立了一支专业门类配套、行业经验丰富、研发能力较强的复合型研发、销售团队。研发带头人谭晓华有十余年半导体化学材料研发、应用、销售经验。截至 2014 年 5 月 31 日，公司共有员工 24 人，其中本科及以上学历 17 人，占员工总数的 70.83%，研发人员 6 人，占员工总数的 25%。与专业研发机构相比，公司的技术团队更加贴近市场，更加掌握客户的实际使用情况和潜在需求，研发效率更高；与专业的使用单位相比，公司的技术团队更加深入和专业，掌握核心技术，可以优化、提高产品属性，满足使用要求。

### （3）客户优势

公司产品主要供应给半导体封装、制造等领域的客户，公司设立以来在行业中积累了较高的知名度和美誉度，公司产品已为多种高科技产品的封装、生产环节提供清模润模整体解决方案，如某国际知名品牌手机、第二代居民身份证等。未来，公司还将为移动电子终端用指纹传感器、智能卡芯片等产品提供封装材料。

公司与行业内知名客户建立了稳定的合作关系，为公司未来业务发展提供了重要基础，也是公司较强综合竞争实力的体现。

### （4）高效的管理模式

公司采用矩阵式流程管理模式，实施扁平化管理，弱化部门职能，强化整体功能。以市场为主线，以技术为主导，围绕新产品的研发设计、生产制造、销售服务，建立核心业务流程；围绕财务管理、人力资源管理等建立关键业务流程；各部门内部建立多层级业务流程，各岗位职责明确。业务流程覆盖公司各类业务，同时将质量管理体系融入到相关业务流程中，形成了业务流程为主、各管理体系为辅的管理格局，构建了机构扁平、职责明确、激励分明、注重效率秩序的现代化管理模式。各部门、各岗位之间能够进行通畅的信息沟通和交流，保证了公司的各项管理有效、规范。

### 3、公司的竞争劣势

#### (1) 存在资金瓶颈

截至本公开转让说明书签署之日，公司实收资本仅 400 万元，属于小微企业，固定资产较少，融资渠道较为单一，融资能力不足，缺乏获得与公司发展速度相匹配的资金支持。因此资金压力成为公司近年来快速发展和规模化经营的瓶颈。

#### (2) 综合实力相对较弱

公司虽然是国内专业的半导体领域所需的清模润模材料、封装材料等电子化学品供应商，但由于设立时间不长，公司的规模、品牌知名度、客户群体、研发投入、产品体系等方面的综合实力同国内外竞争对手比较仍有较大差距，在替代进口产品时面临较高的市场壁垒。

### 4、公司的主要竞争对手

目前，公司在行业内的主要竞争对手有：日立化成株式会社（日本）、IC VISION PTE LTD.（新加坡）、NARA CHEM Co.,LTD.（韩国）、住友电木株式会社（日本）、美国道康宁公司（Dow Corning）、信越化学工业株式会社（日本）、北京康美特科技有限公司等。

日立化成自 1997 年开始研发橡胶清模材料，是资格最老的橡胶清模材料供应商，其产品定价比平均市场定价高出 100%-200%，因此其用户数量非常有限，其市场主要集中于日本本土，在中国的主要用户都是日资公司。日立化成与 2012 年 4 月整合了日东电工 EMC 业务，约占有全球 20% 市场份额。

新加坡 IC VISION，研发和生产均位于新加坡，同时在广东省中山市设有一家包装工厂，并进行直销业务，此外在华东、华北等地区拥有数家代理商。该公司 2004 年开始研发和销售橡胶清模材料，由于其较好的品质，目前在中国市场占有率领先。

韩国 NARA CHEM，研发和生产均位于韩国忠清南道牙山市，在中国的代理商超过 10 家。该公司 2005 年开始研发和销售橡胶清模材料，目前在中国的市场占有率第二。

住友电木，是全球最大的高端 EMC 提供商，2012 年 EMC 材料销售额为 3.4 亿美元，占全球市场份额的 30%。

美国 Dow Corning 成立于 1943 年，是一家由陶氏化学公司和康宁公司均等

持股的合资公司，总部设在美国密歇根州米德兰市。道康宁致力于探索和开发有机硅的应用潜力，现为全球硅胶技术和创新领域的全球领导者。

日本信越化学工业株式会社，作为高科技材料的超级供应商，信越集团不断地提供着最尖端的技术和产品，其半导体硅、聚氯乙烯等原材料的供应在全球首屈一指。

北京康美特科技有限公司，是集研发、制造、销售和服务于一体的高新技术企业。公司专业从事 LED 封装材料及其它高分子材料的研究开发和生产制造。

### **5、公司的竞争地位**

公司目前规模较小，远不及本行业巨头，甚至与国内同行业公司相比亦有较大差距。但是公司依托先进的工艺与技术，在产品质量与可靠性方面表现出明显的市场优势，在部分领域的产品已出现替代进口的趋势。一旦公司产品替代进口，凭借公司产品高度可靠性及低廉的价格，将为公司带来快速的收入增长与利润水平。

## 第三章 公司治理

### 一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司制定了《公司章程》，并根据《公司章程》的规定建立了股东会；未设董事会，但设置了一名执行董事；未设监事会，但设置了一名监事。公司变更经营范围、增加注册资本、进行股权转让、修改章程、整体变更成股份公司等重大事项均履行了股东会决议程序。

有限公司股东会、执行董事、监事制度的运行情况存在一定瑕疵。例如未依照《公司章程》规定按时召开股东会定期会议，部分股东会会议文件缺失等。有限公司执行董事、监事未在有限公司期间形成相应的报告。

股份公司成立以来，按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的法人治理结构，健全了股东大会、董事会、监事会的相关制度。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等制度规则。上述《公司章程》及各项内部管理制度能够从制度层面保证现有公司治理机制为所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权，同时也对投资者关系管理、纠纷解决机制、累积投票制以及财务管理、风险控制事项均进行了相应的规定。

公司能够依照《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署。但由于股份公司成立时间较短，公司治理规范运行的效果还需观察。公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。

公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，设立了制造部、总务部、研发部、财务部、品质保证部、市场销售部等职能部门，建立健全了内部经营管理机构，制定了相应的内部管理制度，比较科学的划分了每个部门的职责权限，形成了互相制衡的机制。

## 二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估

### （一）董事会对现有公司治理机制的讨论

公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法律法规、规章制定了《公司章程》、“三会”议事规则等制度，确立了关联交易管理办法、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度等制度，给所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

#### 1、股东的权利

《公司章程》规定，公司股东享有下列权利：（1）按照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）参加或者委派代理人参加股东大会；（3）依照其所持有的股份份额行使表决权；（4）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（5）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（6）依照法律、行政法规及公司章程的规定查阅有关公司文件，获得公司有关信息；（7）公司终止或清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

#### 2、投资者关系管理

公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。为此，《公司章程》专门对投资者关系管理作出了相关规定，包括了投资者关系管理的工作内容、沟通方式等。

#### 3、纠纷解决机制

《公司章程》规定，本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

#### 4、关联股东和董事回避制度

《公司章程》规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应充分披露非关联股东有表决情况。有关联关系的股东可以自行申请回避，本公司其他股东及公司董事会可以申请有关联关系的股东回避，上述申请应在股东大会召开前以书面形式提出，董事会有义务立即将申请通知有关股东。有关股东可以就上述申请提出异议，在表决前尚未提出异议的，被申请回避的股东应回避；对申请有异议的，可以要求监事会对申请做出决议。关联股东的范畴以及关联交易的审议和信息披露程序按照有关规定和公司董事会制定并提交股东大会审议通过的有关关联交易的具体制度执行。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

#### 5、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

公司制定了《财务管理制度》，对资金管理、资产管理、财务预算、会计核算等方面均进行了具体规定。在风险控制方面，公司制定了《知识产权管理办法》、《产品研发管理制度》、《研发人员绩效考核奖励制度》、《职工技术创新奖励办法》等内部制度，相应风险控制程序涉及业务、技术、财务等多方面，体现了公司风险控制的完整性、合理性和有效性。

##### （二）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司董事会认为，自股份公司设立以来，公司依《公司章程》规定程序召开“三会”会议，确保每次会议程序合法，内容有效。公司重大经营活动的决策和执行均按照公司相关治理制度的要求，履行了相关程序，保护了公司及公司股东的正当权益。公司现有治理机制通过制度设计、有效执行，充分保证了合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，并依法享有知情权、参与权、质询权和表决权等各项股东权利。现有公司治理机制符合相关法律法规要求，运行有效且可以满足公司经营发展需求。

### 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

公司及其控股股东、实际控制人谭晓华最近两年不存在重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。

### 四、公司独立性情况

目前公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人控制的其他企业相互独立，拥有独立完整的资产机构和业务系统，具有独立面向市场自主经营的能力。

#### （一）业务独立情况

公司在业务上独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的业务系统，独立开展业务。公司的采购、生产、销售和研发系统等重要职能完全由公司承担，具有完整的业务流程以及采购、销售渠道。同时，公司控股股东及实际控制人谭晓华出具了避免同业竞争的承诺函，避免与公司发生同业竞争。

#### （二）资产独立情况

公司由有限公司整体变更设立，原有限公司的业务、资产、债权、债务均已整体进入公司。公司合法拥有其办公、生产用房屋、设备的使用权和所有权以及与生产经营相关的商标、专利、认证等资产的所有权。目前，公司对其所有的资产具有完全的控制支配权，没有以公司资产、权益等为股东或他人提供担保，也不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。公司资产独立完整，各项资产产权界定清晰，权属明确。

#### （三）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举、聘任产生；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司员工均由公司自行聘用、管理，独立执行劳动、人事及工资管理制度。

#### （四）机构独立情况

公司已经建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构及相应的议事规则，形成完整的法人治理结构。公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，拥有完整的业务系统及配套部门，各部门已构成一个有机整体，有效运作。公司完全拥有机构设置自主权，并独立行使经营管理职权。公司不存在与其他企业混合经营、合署办公的情况。

#### （五）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备了合格的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策，不受股东或其他单位干预或控制。公司建立了规范的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

### 五、同业竞争情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人谭晓华不存在控制其他企业的情况，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间从事相同、类似业务的情况。

为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东、实际控制人谭晓华签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

1、本人及本人控制和可能施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与天津德高化成新材料股份有限公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

2、本人将不直接或间接从事或参与任何在商业上对天津德高化成新材料股份有限公司构成竞争的业务及活动，或拥有与天津德高化成新材料股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、组织的控制权，或在该经济实体、机构、组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

3、本人作为天津德高化成新材料股份有限公司股东期间，本承诺持续有效。

4、本人愿承担因违反上述承诺而给天津德高化成新材料股份有限公司造成的全部经济损失。

## 六、报告期内公司资金占用、对外担保情况

### （一）控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金的情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

### （二）为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他提供担保的情况。

### （三）防止股东及其关联方侵害公司利益的措施

为进一步完善公司治理，防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，股份公司创立大会会议审议通过了现行的《公司章程》，规定了关联交易的公允决策程序，以切实保护公司及全体股东的利益。公司在《公司章程》中规定公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司和其他股东利益，违反规定给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

同时，为规范公司关联交易行为，公司股东大会还审议通过了《关联交易管理制度》，对关联人和关联交易的界定、关联交易的决策程序等均作出专门规定。

### （四）为规范对外担保所采取的具体安排

为规范公司对外担保行为，公司股东大会还审议通过了《对外担保管理制度》，对对外担保决策程序等均作出专门规定。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事、监事、高级管理人员直接或间接持有公司股份的情况

序号	姓名	职务	持股方式	持股数量（股）	持股比例（%）
1	谭晓华	董事长、总经理	直接持有	2,720,000	68.00
2	霍炬	董事	直接持有	400,000	10.00
3	孙巨龙	董事	直接持有	300,000	7.50
4	方玉辉	监事	直接持有	220,000	5.50
5	冯亚凯	董事	直接持有	80,000	2.00
6	孙绪筠	董事	直接持有	80,000	2.00
7	潘雪莹	董事会秘书	直接持有	50,000	1.25

8	沈六富	监事	直接持有	50,000	1.25
9	李永	职工监事	-	-	-
10	韦谨	财务负责人	-	-	-
	合计	-	-	3,900,000	97.50

公司董事、监事、高级管理人员直系亲属未持有公司股份。

## （二）董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议及作出的重要承诺

公司董事、监事及高级管理人员未与公司签订过重要协议。

除谭晓华签署《关于避免同业竞争的承诺函》之外，其他董事、监事、高级管理人员未作出重要承诺。

## （四）公司董事、监事、高级管理人员兼职情况

冯亚凯为公司董事，现就职于天津大学化工学院。

方玉辉为公司监事会主席，现就任于天津齐泰科技有限公司、天津齐泰国际贸易有限公司。

除冯亚凯、方玉辉外，公司其他董事、监事、高级管理人员，均在公司专职工作，不存在兼职情况。

## （五）公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况

除方玉辉外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在对外投资情况。

方玉辉对外投资情况详见“第四章 公司财务”之“十、关联方、关联方关系和关联方交易”部分。

## （六）公司董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责的情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到过中国证监会的处罚，未被采取市场禁入措施，也不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情况。

## 八、公司董事、监事、高级管理人员在近两年内的变动情况

### （一）董事变动情况

报告期初，方玉辉为有限公司执行董事。

2013年8月1日，有限公司召开股东会，同意将有限公司注册资本由100万元增加至300万元，全部由谭晓华由货币出资，并选举谭晓华为执行董事。

2014年7月18日，股份公司召开股东大会，选举谭晓华、霍炬、孙巨龙、冯亚凯、孙绪筠共同组成公司第一届董事会。同日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举谭晓华为公司董事长。

### （二）监事变动情况

报告期初，翟玉静为有限公司监事。

2013年8月1日，有限公司召开股东会，选举方玉辉为监事。

2014年7月18日，有限公司召开职工代表大会，选举李永为公司职工监事，公司召开股东大会，选举方玉辉、沈六富为公司监事，共同组成公司第一届监事会。同日第一届监事会召开第一次会议，选举方玉辉为公司监事会主席。

### （三）高级管理人员变动情况

报告期初，方玉辉为公司经理。

2013年8月，有限公司召开股东会，聘任谭晓华为经理。

2014年7月18日，公司第一届董事会召开第一次会议，聘任谭晓华为公司总经理、财务负责人，聘任潘雪莹为公司董事会秘书。

2014年9月10日，公司第一届董事会召开第三次会议，同意谭晓华辞去财务负责人职务，并聘任韦谨为公司财务负责人。

## 第四章 公司财务

### 一、公司最近两年一期经审计的财务报表

#### (一) 资产负债表

	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	1,560,484.50	961,430.63	1,588,693.79
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1,041,472.88	1,148,189.75	814,507.88
预付款项	485,331.50	298,876.31	434,526.91
应收利息			
应收股利			
其他应收款	101,255.22	99,259.42	
存货	694,275.89	653,977.99	675,381.43
一年内到期的非流动资产	179,653.09	307,976.73	
其他流动资产			
流动资产合计	4,062,473.08	3,469,710.83	3,513,110.01
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	1,332,140.32	1,469,442.39	833,261.07
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			400,000.00
递延所得税资产	97,498.64	98,372.75	102,430.32
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,429,638.96	1,567,815.14	1,335,691.39
资产总计	5,492,112.04	5,037,525.97	4,848,801.40

## (二) 资产负债表 (续)

	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债:			
短期借款			1,700,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	133,271.00	173,141.00	66,751.71
预收款项	103,330.00	120,450.00	16,800.00
应付职工薪酬	59,044.90	485,787.91	
应交税费	198,544.10	257,547.31	217,213.54
应付利息			
应付股利			
其他应付款	96,573.59	114,172.59	1,170,676.30
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	590,763.59	1,151,098.81	3,171,441.55
非流动负债:			
长期借款			

应付债券			
长期应付款			
专项应付款	490,000.00	490,000.00	490,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	100,000.00	100,000.00	150,000.00
非流动负债合计	590,000.00	590,000.00	640,000.00
负债合计	1,180,763.59	1,741,098.81	3,811,441.55
所有者权益：			
实收资本	4,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00
资本公积			
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	29,642.72	29,642.72	3,735.99
一般风险准备			
未分配利润	281,705.73	266,784.44	33,623.86
所有者权益合计	4,311,348.45	3,296,427.16	1,037,359.85
负债和所有者权益总计	5,492,112.04	5,037,525.97	4,848,801.40

### (三) 利润表

	2014年1-5月	2013年度	2012年度
一、营业收入	3,646,447.06	11,660,105.55	6,161,618.94
减：营业成本	1,265,541.08	5,058,511.05	2,030,892.67
营业税金及附加	53,136.00	138,487.43	82,487.90
销售费用	693,935.83	1,693,888.59	1,414,700.86
管理费用	1,727,908.25	4,537,482.40	1,902,738.58
财务费用	1,198.88	88,431.36	2,215.49
资产减值损失	-5,827.43	22,949.54	13,360.21
加：公允价值变动收益			
投资收益			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润	-89,445.55	120,355.18	715,223.23
加：营业外收入	107,000.00	226,340.00	54,640.00
减：营业外支出		2.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额	17,554.45	346,693.18	769,863.23
减：所得税费用	2,633.16	87,625.87	67,932.94
四、净利润	14,921.29	259,067.31	701,930.29
五、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）	0.00	0.17	0.70
（二）稀释每股收益（元/股）	0.00	0.17	0.70
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	14,921.29	259,067.31	701,930.29

#### （四）现金流量表

	2014年1-5月	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	4,329,814.58	13,357,743.23	6,938,943.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	107,647.62	190,565.05	696,647.84
经营活动现金流入小计	4,437,462.20	13,548,308.28	7,635,590.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,350,764.64	4,799,849.37	2,391,008.90
支付给职工以及为职工支付的现金	1,725,922.21	2,663,610.59	1,466,224.85
支付的各项税费	505,864.73	1,304,236.47	815,176.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,170,814.03	4,569,039.89	2,880,578.20
经营活动现金流出小计	4,753,365.61	13,336,736.32	7,552,988.20
经营活动产生的现金流量净额	-315,903.41	211,571.96	82,602.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,042.72	1,043,003.41	362,959.42
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	85,042.72	1,043,003.41	362,959.42
投资活动产生的现金流量净额	-85,042.72	-1,043,003.41	-362,959.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	2,000,000.00	
取得借款收到的现金		1,450,000.00	1,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	3,450,000.00	1,700,000.00
偿还债务支付的现金		3,150,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,831.71	939.17
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,248,831.71	939.17
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,000.00	201,168.29	1,699,060.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	599,053.87	-630,263.16	1,418,704.09
加：期初现金及现金等价物余额	958,430.63	1,588,693.79	169,989.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,557,484.50	958,430.63	1,588,693.79

## (五) 所有者权益变动表

项目	2014年1-5月							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	3,000,000.00				29,642.72		266,784.44	3,296,427.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,000,000.00				29,642.72		266,784.44	3,296,427.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,000,000.00						14,921.29	1,014,921.29
（一）净利润							14,921.29	14,921.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							14,921.29	14,921.29
（三）股东投入和减少资本	1,000,000.00							1,000,000.00
1. 股东投入资本	1,000,000.00							1,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对股东的分配								
4.其他								
(五) 股东权益内部结转								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六) 专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	4,000,000.00				29,642.72		281,705.73	4,311,348.45
项目	2013 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计

一、上年年末余额	1,000,000.00				3,735.99		33,623.86	1,037,359.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,000,000.00				3,735.99		33,623.86	1,037,359.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,000,000.00				25,906.73		233,160.58	2,259,067.31
（一）净利润							259,067.31	259,067.31
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							259,067.31	259,067.31
（三）股东投入和减少资本	2,000,000.00							2,000,000.00
1. 股东投入资本	2,000,000.00							2,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					25,906.73		-25,906.73	
1. 提取盈余公积					25,906.73		-25,906.73	
2. 提取一般风险准备								

3.对股东的分配								
4.其他								
(五) 股东权益内部结转								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六) 专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	3,000,000.00				29,642.72		266,784.44	3,296,427.16
项目	2012 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,000,000.00						-664,570.44	335,429.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年初余额	1,000,000.00						-664,570.44	335,429.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,735.99		698,194.30	701,930.29
（一）净利润							701,930.29	701,930.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							701,930.29	701,930.29
（三）股东投入和减少资本								
1.股东投入资本								
2.股份支付计入股东权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					3,735.99		-3,735.99	
1.提取盈余公积					3,735.99		-3,735.99	
2.提取一般风险准备								
3.对股东的分配								
4.其他								
（五）股东权益内部结转								

1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六) 专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	1,000,000.00				3,735.99		33,623.86	1,037,359.85

## 二、公司最近两年及一期财务会计报告的审计意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司两年及一期的财务会计报告进行了审计，并出具了大信审字[2014]第 11-00211 号审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2014 年 5 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年 1-5 月份、2013 年度、2012 年度的经营成果和现金流量。

## 三、公司主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2014 年 5 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年 1-5 月、2013 年度、2012 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### （三）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （五）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## （六）外币业务及外币财务报表折算

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率（中国人民银行公布的人民币外汇牌价的中间价）折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## （七）金融工具

### 1、金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

## **2、金融资产转移的确认依据和计量方法**

本公司金融资产转移的确认依据:金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量:金融资产满足终止确认条件,应进行金融资产转移的计量,即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计

入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

### 3、金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 4、金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

### 5、金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出

并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

## 6、金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

### (八) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债

表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单独测试未发生减值应收款项，将其归入关联方组合或账龄组合计提坏账准备。

### 2、按组合计提坏账准备的应收款项：

项目	确定组合的依据
无风险组合	对单项金额重大或者具有某些特定风险特征的应收款项单独进行减值测试以后，管理层认为于资产负债表日未发生减值的应收款项，本公司内部应收款项（含职工备用金）被认定为无风险组合。
一般风险组合	指管理层对于不符合单独进行减值测试的标准（单项金额重大或者具有某些特定风险特征），因而采用账龄等信用风险特征作为分类依据划分为若干组合，针对每一组合共同的信用风险特征确定各组合的坏账准备计提比例，以信用风险组合为单位计提坏账准备的应收款项。

按组合计提坏账准备的计提方法为：

无风险组合	不计提坏账
一般风险组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
-------------	--

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
-----------	--

## （九）存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在途物资、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

## （十）长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

## 4、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

## （十一）投资性房地产

### 1、投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。

### 2、采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

## （十二）固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：电子设备、生产器具、生产设备、运输工具等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产

计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
电子设备	3	1.00%	33%
生产器具	5	1.00%	19.80%
生产设备	10	1.00%	9.9%
运输工具	4	1.00%	24.75%

### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

### 4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### （十三）在建工程

#### 1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

#### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### 3、在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

### （十四）借款费用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### 2、资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## （十五）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### 3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### 4、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

### 5、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计

划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

#### **（十六）长期待摊费用**

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### **（十七）预计负债**

##### **1、预计负债的确认标准**

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

##### **2、预计负债的计量方法**

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### **（十八）收入**

##### **1、销售商品**

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

## 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度,在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

## 3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

### (十九) 政府补助

#### 1、政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

#### 2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益;按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

#### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。

#### 4、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助,确认为递延收益,自相关资产可供使用时起,按照相关资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。

## 5、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### （二十）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### （二十一）租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

### （二十二）持有待售资产

#### 1、持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

## 2、持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产,比照上述原则处理,持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组,处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

### (二十三) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

#### 1、主要会计政策变更说明

本公司报告期内无应披露的主要会计政策变更事项。

#### 2、主要会计估计变更说明

本公司报告期内无应披露的主要会计估计变更事项。

### (二十四) 前期会计差错更正

本公司报告期内无应披露的前期会计差错更正事项。

## 四、公司最近两年及一期的主要财务数据和财务指标分析

项目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产(元)	5,492,112.04	5,037,525.97	4,848,801.40
股东权益合计(元)	4,311,348.45	3,296,427.16	1,037,359.85
归属于申请挂牌公司股东权益合计(元)	4,311,348.45	3,296,427.16	1,037,359.85
每股净资产(元/股)	1.08	1.10	1.04
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.08	1.10	1.04
资产负债率(%)	21.50	23.56	78.61
流动比率(倍)	6.88	3.01	1.11
速动比率(倍)	5.70	2.45	0.89
项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度

营业收入（元）	3,646,447.06	11,660,105.55	6,161,618.94
净利润（元）	14,921.29	259,067.31	701,930.29
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	14,921.29	259,067.31	701,930.29
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-97,906.14	55,678.85	660,650.50
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-97,906.14	55,678.85	660,650.50
毛利率（%）	65.29	56.62	67.04
净资产收益率（%）	0.45	15.54	74.32
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-2.96	3.34	69.95
基本每股收益（元/股）	0.00	0.17	0.70
稀释每股收益（元/股）	0.00	0.17	0.70
应收账款周转率（次）	3.33	11.88	9.10
存货周转率（次）	5.41	17.54	11.46
经营活动产生的现金流量净额(元)	-315,903.41	211,571.96	82,602.68
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.10	0.14	0.08

## （一）盈利能力分析

### 1、毛利率

公司 2014 年 1-5 月份、2013 年度、2012 年度的毛利率分别为 65.29%、56.62%、67.04%。由于公司产品技术含量高，市场议价能力强，故公司毛利率处于较高水平。

2013 年公司毛利率有所下降系由于该年度公司开发的半导体芯片胶膜、LED 硅胶投入市场，销售额共计约 200 万元，该两类产品生产过程中大量使用进口原材料，由于原材料价格较高，导致该等产品毛利较低，使得公司 2013 年度整体毛利率下滑。2014 年公司放弃半导体胶膜材料产品，LED 硅胶通过研发改进后转用国产原材料，故 2014 年公司毛利回升。

### 2、净利率

公司 2014 年 1-5 月份、2013 年度、2012 年度的销售净利率分别为 0.41%、2.22%、11.39%，2013 年较 2012 年净利下降系由于公司整体产品毛利下降；2014

年 1-5 月份净利下降系由于本行业季节性所致，同时销售收入较去年同期下降，一般下半年半导体封装材料销售收入明显高于上半年。

### 3、净资产收益率及每股收益

公司 2014 年 1-5 月份、2013 年度、2012 年度净资产收益率分别为 0.45%、15.54%、74.32%，每股收益分别为 0.00 元、0.17 元、0.70 元。公司 2013 年净资产收益率较 2012 年下降 79.09%，每股收益较 2012 年下降 75.71%，系由于 2013 年净利率较 2012 年下降 44.29 万元，且 2013 年 9 月公司实收资本由 100 万元增加值 300 万元；公司 2014 年 1-5 月份净资产收益率及每股收益较 2013 下降，主要系由于行业季节性因素及加大费用投入所致。

### 4、扣除非经常新损益后的净资产收益率

公司 2014 年 1-5 月份、2013 年度、2012 年度扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为-2.96%、3.34%、69.95%。非经常性损益主要是政府补贴收入，2014 年 1-5 月份、2013 年度、2012 年度，公司获得的直接计入当期损益的政府补助分别为 10.70 万元、22.61 万元、5.46 万元。

## （二）偿债能力分析

公司 2014 年 5 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日的资产负债率分别为 21.50%、23.56%、78.61%。公司负债主要为经营活动中产生的往来余额，其中 2012 年 12 月 31 日还包括短期借款 170 万元。2014 年 5 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日公司的流动比率分别为 6.88、3.01、1.11，速动比率分别为 5.70、2.45、0.89。

从最近一期数据来看，公司具备较强的偿债能力，债务风险较小。公司董事会认为，公司可适当提高财务杠杆，以便进一步优化资产负债结构。

## （三）营运能力分析

2014 年 5 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日，公司应收账款报表余额分别为 1,041,472.88 元、1,148,189.75 元、814,507.88 元，公司 2014 年 1-5 月份、2013 年度、2012 年度平均应收账款周转率分别为 3.33、11.88、9.10，应收账款周转率较高。公司 2013 年应收账款周转率上升原因主要系由于 2013 年销售收大幅增加，2014 年 1-5 月份应收账款周转率下降系由于行业季节性所致，该行业一般下半年销售高于上半年。公司管理层认为，公司目前规模较小，应严

格控制客户的信用额度、汇款周期，确保应收账款按计划回收。报告期内，公司客户一般回款周期为 30 天。

公司主要客户信誉良好，具备较强实力，与公司有长期业务往来。公司应收账款账龄较短，截至 2014 年 5 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日，公司 1 年以内应收账款占应收账款余额的比例分别为 99.72%、99.74%、100.00%，应收账款质量较好。

2014 年 1-5 月份、2013 年度、2012 年度公司存货周转率分别为 5.41、17.54、11.46，期末存货余额分别为 69.43 万元、65.40 万元、67.54 万元。由于公司实行以销定产的方式组织生产，存货数量较低，周转情况良好。

综上所述，公司应收账款周转率、存货周转率处于较高水平，公司整体运营状况良好。

#### （四）经营活动现金流量分析

2014 年 1-5 月份、2013 年度、2012 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-31.59 万元、21.15 万元、8.26 万元，每股经营活动产生的现金流量净额分别为-0.10 元、0.14 元、0.08 元。

2014 年 1-5 月份、2013 年度、2012 年度公司经营活动现金流入金额分别为 443.75 万元、1354.83 万元、763.56 万元，其中：

1、2014 年 1-5 月份、2013 年度、2012 年度公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为 432.98 万元、1,335.58 万元、693.89 万元，而同期公司营业收入分别为 364.64 万元、1,166.01 万元、616.16 万元，差异主要为销项税额。

2、2014 年 1-5 月份、2013 年度、2012 年度公司收到其他与经营活动有关的现金分别为 10.76 万元、19.06 万元、69.66 万元，主要为公司收到政府的财政补贴。

2014 年 1-5 月份、2013 年度、2012 年度公司经营活动现金流出金额分别为 475.34 万元、1,333.67 万元、755.30 万元，其中：

1、2014 年 1-5 月份、2013 年度、2012 年度购买商品、接受劳务支付的现金分别为 135.08 万元、479.98 万元、239.10 万元，

2、2014 年 1-5 月份、2013 年度、2012 年度支付给职工以及为职工支付的现金分别为 172.59 万元、266.36 万元、146.62 万元，原因为公司员工人数有所

增加，同时工资水平也有所提升。

3、2014年1-5月份、2013年度、2012年度支付其他与经营活动有关的现金分别为117.08万元、456.90万元、288.06万元，主要为管理费用及销售费用支出。

## 五、报告期内各期末主要资产情况

### （一）货币资金

项目	2014年5月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	原币	人民币（元）	原币	人民币（元）	原币	人民币（元）
现金	-	40,813.24	-	121,836.42	-	0.02
银行存款	-	1,519,671.26	-	839,594.21	-	1,588,693.77
合计	-	1,560,484.50	-	961,430.63	-	1,588,693.79

2014年5月31日，公司货币资金较2012年12月31日增长62.31%，主要是2014年5月份公司增资吸收股东出资所致。2013年12月31日公司货币资金较2012年12月31日降低39.48%，主要是由于公司2013年度购买固定资产以及支出研发费用增加所致。

### （二）应收账款

#### 1、按账龄分类

账龄	2014年5月31日（元）			2013年12月31日（元）			2012年12月31日（元）		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	1,093,350.40	99.72%	54,667.52	1,205,683.95	99.74%	60,284.20	857,376.72	100.00%	42,868.84
1至2年	3100.00	0.28%	310.00	3,100.00	0.26%	310.00			
2至3年									
合计	1,096,450.40	100.00	54,977.52	1,208,783.95	100.00	60,594.20	857,376.72	100.00	42,868.84

2014年5月31日、2013年12月31日、2012年12月31日，公司应收账款账面余额分别为1,096,450.40元、1,208,783.95元、857,376.72元，计提坏账金额分别为54,977.52元、60,594.20元、42,868.84元。整体来讲公司应收账款期末余额不大，且绝大部分账龄在1年以内，公司应收账款产生坏账风险较小。2013年12月31日应收账款较2012年12月31日增加40.97%，增长幅度较大，系由于公司销售收入大幅上涨，相应的正常信用期应收账款增加。

## 2、按种类分类

### ①2014年5月31日

种类	账面余额		坏账准备	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 无风险组合				
组合 2: 一般风险组合	1,096,450.40	100.00	54,977.52	5.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,096,450.40	100.00	54,977.52	

### ②2013年12月31日

种类	账面余额		坏账准备	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 无风险组合				
组合 2: 一般风险组合	1,208,783.95	100.00	60,594.20	5.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,208,783.95	100.00	60,594.20	

### ③2012年12月31日

种类	账面余额		坏账准备	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 无风险组合				

组合 2：一般风险组合	857,376.72	100.00	42,868.84	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	857,376.72	100.00	42,868.84	

### 3、各期末应收账款前五名单位情况

#### ①2014 年 5 月 31 日

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
上海旭福电子有限公司	非关联方	424,075.00	1 年以内	38.68
凤凰半导体通信（苏州）有限公司	非关联方	212,495.40	1 年以内	19.38
无锡华润安盛科技有限公司	非关联方	152,334.00	1 年以内	13.89
天津齐泰科技有限公司	关联方	92,822.00	1 年以内	8.47
上海芯哲微电子科技有限公司	非关联方	76,200.00	1 年以内	6.95
合计	-	957,926.40	-	87.37

#### ②2013 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
上海旭福电子有限公司	非关联方	392,300.00	1 年以内	32.45
凤凰半导体通信（苏州）有限公司	非关联方	291,727.80	1 年以内	24.13
天津齐泰科技有限公司	关联方	225,097.75	1 年以内	18.62
扬州江新电子有限公司	非关联方	74,250.00	1 年以内	6.14
无锡华润安盛科技有限公司	非关联方	52,416.00	1 年以内	4.34
		1,035,791.55		85.69

#### ③2012 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
凤凰半导体通信（苏州）有限公司	非关联方	367,556.72	1 年以内	42.87

天津齐泰科技有限公司	关联方	190,710.00	1年以内	20.24
上海旭福电子有限公司	非关联方	178,350.00	1年以内	20.80
扬州江新电子有限公司	非关联方	82,500.00	1年以内	9.62
苏州立泰电子有限公司	非关联方	27,750.00	1年以内	3.24
合计		846,866.72		98.77

上述应收账款较大的客户均为与公司长期合作的大客户，客户资产质量、经营状况和信用情况均较好，且上述应收账款账龄均在1年以内，公司应收账款总体质量较好。

公司应收关联方账款情况详见本公开转让说明书“第四章 公司财务”之“十、关联方、关联方交易及关联方交易情况”部分。

### （三）预付款项

#### 1、按账龄列示情况

账龄	2014年5月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	347,331.50	71.57	148,876.31	49.81	297,526.91	68.47
1至2年	1,000.00	0.20	13,000.00	4.35	137,000.00	31.53
2至3年	137,000.00	28.23	137,000.00	45.84		
3年以上						
合计	485,331.50	100.00	298,876.31	100.00	434,526.91	100.00

2014年5月31日公司预付款项较2013年12月31日增长62.39%，主要是由于公司预付房租、环境监测费用及本次挂牌律师服务费所致；2013年12月31日公司预付款项较2012年12月31日下降31.22%，主要是由于公司2013年度采购管理加强，从款项支付到收货再到发票入账周期缩短。

#### 2、期末预付款项前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额（元）	比例（%）	未结算原因
大连德通橡塑机械有限公司	客户	137,000.00	28.23	预付设备款，设备尚未提供
创新创业园管理公司	客户	81,229.60	16.74	预付物业款
北京市中银律师事务所	客户	45,000.00	9.27	项目未完成

天津市环科检测技术有限公司	客户	44,365.00	9.14	项目未完成
上海弘屏电子科技有限公司	客户	40,000.00	8.24	未收货
合计	-	347,594.60	71.62	-

#### (四) 其他应收款

##### 1、按账龄分类情况

账龄	2014年5月31日			2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	100,268.65	100.00	5,013.43	104,483.60	100.00	5,224.18			
1至2年									
2至3年									
3至4年									
4至5年									
5年以上									
合计	100,268.65	100.00	5,013.43	104,483.60	100.00	5,224.18			

截至2014年5月31日，公司其他应收款金额较低，且账龄均在一年以内，且主要为房屋、物业费押金，不存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情况。

##### 2、按种类列示

###### ①2014年5月31日

种类	账面余额		坏账准备	
	金额(元)	比例(%)	金额	计提比例(%)
1 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2 按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1: 无风险组合	6,000.00	5.65		
组合2: 一般风险组合	100,268.65	94.35	5,013.43	5.00
3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	106,268.65	100.00	5,313.43	

###### ②2013年12月31日

种类	账面余额		坏账准备	
	金额（元）	比例（%）	金额	计提比例（%）
1 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2 按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1：无风险组合				
组合 2：一般风险组合	104,483.60	100.00	5,224.18	5.00
3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	104,483.60	100.00	5,224.18	

### 3、各期末其他应收款前五名单位

#### ①2014 年 5 月 31 日

单位名称	与公司关系	金额（元）	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	备注
天津塘沽海洋高新区创新创业园服务中心	非关联方	50,000.00	1 年以内	47.05	厂房、办公场所押金
夏文建	非关联方	22,000.00	1 年以内	20.70	办公场所押金
万通新城	非关联方	2,800.00	1 年以内	2.63	宿舍押金
蔡伟鸣	非关联方	5,000.00	1 年以内	4.71	宿舍押金
上海优联物业管理有限公司	非关联方	3,233.60	1 年以内	3.04	物业费押金
合计	-	83,033.60	-	78.14	

#### ②2013 年 12 月 31 日

单位名称	与公司关系	金额（元）	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	备注
天津塘沽海洋高新区创新创业园服务中心	非关联方	50,000.00	1 年以内	47.85	厂房、办公场所押金
夏文建	非关联方	22,000.00	1 年以内	21.06	办公场所押金
上海平康物业	非关联方	18,250.00	1 年以内	17.47	宿舍押金

管理有限公司					
蔡伟鸣	非关联方	5,000.00	1年以内	4.79	宿舍押金
上海优联物业管理有限公司	非关联方	3,233.60	1年以内	3.09	物业费押金
合计	-	98,483.60	-		

### (五) 存货

2014年5月31日、2013年12月31日、2012年12月31日，公司存货账面价值分别为694,275.89元、653,977.99元、675,381.43元，公司各期末存货金额及变动幅度均较小。

公司各期末存货按种类列示如下：

#### ①2014年5月31日

存货项目	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	575,442.87		575,442.87
库存商品	118,833.02		118,833.02
合计	694,275.89		694,275.89

#### ②2013年12月31日

存货项目	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	442,193.98		442,193.98
库存商品	211,784.01		211,784.01
合计	653,977.99		653,977.99

#### ③2012年12月31日

存货项目	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	477,930.29		477,930.29
库存商品	197,451.14		197,451.14
合计	675,381.43		675,381.43

### (六) 固定资产

固定资产及其累计折旧和增减变动如下：

项目	2012年12月31日	2013年增加	2013年减少	2013年12月31日	2014年增加	2014年减少	2014年5月31日
一、原价合计	1,365,487.44	1,043,003.41		2,408,490.85	85,042.72		2,493,533.57

电子设备	618,239.49	215,016.27		833,255.76	41,025.64		874,281.40
生产器具	264,731.54	487,816.21		752,547.75	44,017.08		796,564.83
生产设备	357,581.19	340,170.93		697,752.12			697,752.12
运输工具	124,935.22			124,935.22			124,935.22
二、累计折旧合计	532,226.37	406,822.09		939,048.46	222,344.79		1,161,393.25
电子设备	168,667.82	225,009.38		393,677.20	104,695.28		498,372.48
生产器具	118,383.12	108,862.57		227,245.69	78,554.15		305,799.84
生产设备	162,718.15	42,028.66		204,746.81	28,788.25		233,535.06
运输工具	82,457.28	30,921.48		113,378.76	10,307.11		123,685.87
三、减值准备累计金额合计							
电子设备							
生产器具							
生产设备							
运输工具							
四、账面价值合计	833,261.07			1,469,442.39			1,332,140.32
电子设备	449,571.67			439,578.56			375,908.92
生产器具	146,348.42			525,302.06			490,764.99
生产设备	194,863.04			493,005.31			464,217.06
运输工具	42,477.94			11,556.46			1,249.35

报告期内各期末固定资产的增加系由于公司购入新产品研发、生产所需的研发设备、生产器具等。

截至 2014 年 5 月 31 日，公司固定资产未发现可变现净值低于账面价值的迹象，未计提固定资产减值准备。

#### （七）长期待摊费用

公司长期待摊费用为房屋装修费，租入固定资产的装修费在合同约定的租赁期内摊销，合同约定租期自 2013 年 3 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日；其他减少数为重分类入一年内到期非流动资产金额。

项目	2012年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2013年12月31日
租入固定资产装修费	400,000.00	164,624.00	256,647.27	307,976.73	0.00
合计	400,000.00	164,624.00	256,647.27	307,976.73	0.00

### (八) 递延所得税资产

项目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
递延收益	15,000.00	15,000.00	22,500.00
资产减值准备	8,998.64	9,872.75	6,430.32
专项应付款	73,500.00	73,500.00	73,500.00
小计	97,498.64	98,372.75	102,430.32

### (九) 资产减值损失

#### 1、资产减值损失计提依据

报告期内，公司资产减值损失为应收款项坏账损失，报告期内，公司应收款项坏账计提依据如下：

在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

#### ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单独测试未发生减值应收款项，将其归入关联方组合或账龄组合计提坏账准备。

#### ② 按组合计提坏账准备的应收款项：

项目	确定组合的依据
无风险组合	对单项金额重大或者具有某些特定风险特征的应收款项单独进行减值测试以后，管理层认为于资产负债表日未发生减值的应收款项，本公司内部应收款项（含职工备用金）被认定为无风险组合。
一般风险组合	指管理层对于不符合单独进行减值测试的标准（单项金额重大或者具有某些特定风险特征），因而采用账龄等信用风险特征作为分类依据划分为若干组合，针对每一组合共同的信用风险特征确定各组合的坏账准备计提比例，以信用风险组合为单位计提坏账准备的应收款项。

按组合计提坏账准备的计提方法为：

无风险组合	不计提坏账
一般风险组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	30.00	30.00
3至4年	50.00	50.00
4至5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 2、资产减值损失计提情况

报告期内公司资产减值损失均为坏账准备，且金额较低。公司资产减值准备明细如下：

①2013年度

项目	2012年12月31日	本期增加数		本期减少额			2013年12月31日
		本期计提	合并增加	合并减少	转回	转销	
一、坏账准备	42,868.84	22,949.54					65,818.38
合计	42,868.84	22,949.54					65,818.38

②2014年度

项目	2012年12月31日	本期增加数		本期减少额			2013年12月31日
		本期计提	合并增加	合并减少	转回	转销	
一、坏账准备	65,818.38				5,827.43		59,990.95
合计	65,818.38				5,827.43		59,990.95

## 六、报告期内各期末主要负债情况

### (一) 短期借款

借款条件	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
质押借款			
抵押借款			700,000.00
保证借款			
信用借款			1,000,000.00
合计			1,700,000.00

2012年12月14日，公司与中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行签订借款合同，取得授信350万元授信额度，由谭晓华、方玉辉以个人房产提供担保。该合同项下实际借款金额、借款期限如下：

借款金额	发放日期	借款期限
700,000.00	2012年12月14日	2012年12月14日-2013年11月26日
1,450,000.00	2013年9月9日	2013年9月9日-2013年11月26日

谭晓华、方玉辉为公司提供担保的具体情况如下：

抵押人	抵押权人	合同编号	抵押物	抵押物价值	担保范围
谭晓华	中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行	12100220120008917	房地证津字第114021203148号	157万元	合同编号为12010120120001079的流动资金贷款合同项下105万元借款
方玉辉	中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行	12100220120008918	房地证津字第114021004309号	166万元	合同编号为12010120120001079的流动资金贷款合同项下110万元借款

2012年12月1日公司向实际控制人谭晓华借款100万元，为期一年，约定年利率为6%，该笔借款实际向谭晓华支付利息3万元，谭晓华自愿放弃另外3万元利息收益权。

截至2014年5月31日，公司无未偿还的到期借款。

### (二) 应付账款

报告期内，公司应付账款按账龄列示如下：

项目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日

	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	133,271.00	100.00	173,141.00	100.00	66,751.71	100.00
1至2年						
2至3年						
3年以上						
合计	133,271.00	100.00	173,141.00	100.00	66,751.71	100.00

应付账款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

### （三）预收款项

报告期内，公司预收款项按账龄列示如下：

项目	2014年5月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	103,330.00	100.00	120,450.00	100		
1至2年					16,800.00	100.00
2至3年						
3年以上						
合计	103,330.00	100.00	120,450.00	100	16,800.00	100.00

预收款项中无预收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。

### （四）应交税费

税种	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
增值税	32,506.65	-3,053.79	37,676.95
城建税	4,027.70	1,538.47	4,424.21
企业所得税	148,370.67	203,447.32	164,889.11
地方教育费附加	1,150.77	439.57	1,264.06
个人所得税	10,186.76	54,296.61	6,431.09
教育费附加	1,726.16	659.35	1,896.09
防洪费	575.39	219.78	632.03
合计	198,544.10	257,547.31	217,213.54

### （五）其他应付款

公司其他应收款按账龄列示情况如下：

项目	2014年5月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	96,573.59	100.00	114,172.59	100.00	1,170,676.30	100.00
1至2年						
2至3年						
3年以上						
合计	96,573.59	100.00	114,172.59	100.00	1,170,676.30	100.00

截至2014年5月31日，金额较大的其他应付款情况如下：

单位名称	与公司关系	金额	占其他应收款总额比例(%)	其他应付款性质或内容
创业园服务中心	非关联方	40,614.80	42.06	办公区管理费等
上海办公室房租	非关联方	12,000.00	12.43	房租
张大巍	非关联方	8,400.00	8.70	垫支费用
潘雪莹	关联方	8,832.00	9.15	垫支费用
翟玉静	关联方	8,026.09	8.31	垫支费用
合计		77,872.89	80.64	-

截至2014年5月31日，其他应付款中包含应付谭晓华个人款项6,682.45元。

报告期内，公司其他应付款金额较低，应付关联方款项主要是关联方执行公司事务所发生的垫支费用，不存在公司依赖关联方资金的情况。

#### (六) 专项应付款

项目	2012年12月31日	2013年增加	2013年减少	2013年12月31日	2014年增加	2014年减少	2014年5月31日
国家科技部创新基金	490,000.00			490,000.00			490,000.00
合计	490,000.00			490,000.00			490,000.00

依据与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心签订的《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同》，公司于2012年取得国家科技部创新基金490,000.00元，依据合同约定，该款项计入专项应付款核算，其中：消耗部分予

以核销，形成资产部分转入资本公积。

### （七）其他非流动负债

公司其他非流动负债为天津市科委创新基金项目，具体如下：

项目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
天津市科委创新基金	100,000.00	100,000.00	150,000.00
合计	100,000.00	100,000.00	150,000.00

依据与天津市滨海新区塘沽管理委员会签订的《天津市科技计划项目(课题)任务合同书》，公司于2012年收到天津市科委创新基金150,000.00元，其中50,000.00元用于补助能源材料费，100,000.00元用于购买设备，公司于2013年将用于补助能源材料费的50,000.00元计入“营业外收入-政府补助”科目。

## 七、报告期内各期末所有者权益情况

### （一）实收资本

#### ①2012年变动情况

股东	2012年12月31日	本次变动增减(+、-)					2013年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
李湘风	380,000.00						380,000.00
方玉辉	220,000.00						220,000.00
连爱祺	200,000.00						200,000.00
翟玉静	200,000.00						200,000.00
合计	1,000,000.00						1,000,000.00

#### ②2013年变动情况

股东	2012年12月31日	本次变动增减(+、-)					2013年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
谭晓华		2,000,000.00				2,000,000.00	2,000,000.00
李湘风	380,000.00						380,000.00
方玉辉	220,000.00						220,000.00
连爱祺	200,000.00						200,000.00

翟玉静	200,000.00						200,000.00
合计	1,000,000.00						3,000,000.00

## ②2014年1-5月份变动情况

股东	2012年12月31日	本次变动增减(+、-)					2013年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
谭晓华	2,000,000.00	340,000.00			380,000.00	720,000.00	2,720,000.00
李湘风	380,000.00				-380,000.00	-380,000.00	
方玉辉	220,000.00						220,000.00
连爱祺	200,000.00				-200,000.00	-200,000.00	
翟玉静	200,000.00				-200,000.00	-200,000.00	
霍炬		200,000.00			200,000.00	400,000.00	400,000.00
孙巨龙		100,000.00			200,000.00	300,000.00	300,000.00
冯亚凯		80,000.00				80,000.00	80,000.00
康立红		100,000.00				100,000.00	100,000.00
孙绪筠		80,000.00				80,000.00	80,000.00
潘雪莹		50,000.00				50,000.00	50,000.00
沈六富		50,000.00				50,000.00	50,000.00
合计	3,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	4,000,000.00

2013年9月，公司注册资本增加200万元，由谭晓华以货币投入。2013年9月18日，天津康永联合会计师事务所（普通合伙）对以上出资进行了审验，并出具了康永（2013）065号验资报告。

2014年5月根据股东会决议，公司增加注册资金1,000,000.00元，全部为货币出资。本次增资未进行验资，系由于2014年《公司法》、《公司登记管理条例》修改后，取消了验资作为公司增资必要程序的相关规定。

## （二）盈余公积

## ①2012年变动情况

项目	2011年12月31日	本期增加额	本期减少额	2012年12月31日
法定盈余公积		3,735.99		3,735.99

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计		3,735.99		3,735.99

## ②2013 年变动情况

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2012 年 12 月 31 日
法定盈余公积	3,735.99	25,906.73		29,642.72
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	3,735.99	25,906.73		29,642.72

## ③2014 年 1-5 月份变动情况

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2012 年 12 月 31 日
法定盈余公积	29,642.72			29,642.72
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	29,642.72			29,642.72

## (三) 未分配利润

## ①2012 年

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	-664,570.44	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	701,930.29	-
减：提取法定盈余公积	3,735.99	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	33,623.86	

## ②2013 年

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	33,623.86	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	233,160.58	-
减：提取法定盈余公积	25,906.73	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	266,784.44	

## ③2014 年 1-5 月份

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	266,784.44	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,921.29	-
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	281,705.73	

## 八、报告期内利润形成的有关情况

### （一）收入、成本确认方法

公司主要从事半导体封装材料的研发、生产和销售业务。公司销售收入确认严格按照风险转移原则，公司发货并经客户验收合格，取得对方出具的验收单据作为风险报酬转移的时点并确认销售收入，同时结转成本。

## (二) 营业收入的构成明细及变动分析

### 1、报告期营业收入的构成情况

报告期内，公司营业收入均为半导体行业产品及相关劳务收入，公司营业收入均为主营业务收入，不存在其他业务收入。公司主营业务收入情况如下：

行业名称	2014年1-5月(元)		2013年度(元)		2012年度(元)	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
封装材料	3,646,447.06	1,265,541.08	11,660,105.55	5,058,511.05	6,161,618.94	2,030,892.67
合计	3,646,447.06	1,265,541.08	11,660,105.55	5,058,511.05	6,161,618.94	2,030,892.67

公司2013年营业收入为11,660,105.55元，较2012年的6,161,618.94元增长89.24%，实现了良好的业务增长。

### 2、报告期内营业收入按产品分类情况

项目	2014年1-5月(元)		2013年度(元)		2012年度(元)	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
产品收入	3,608,641.54	1,265,541.08	11,450,027.65	5,058,511.05	6,134,930.74	2,030,892.67
咨询收入	37,805.52		210,077.90		26,688.20	
合计	3,646,447.06	1,265,541.08	11,660,105.55	5,058,511.05	6,161,618.94	2,030,892.67

2014年1-5月份、2013年度、2012年度，公司业务收入主要来自于半导体封装材料的销售收入，分别为3,646,447.06元、11,450,027.65元、6,134,930.74元，占当期营业收入的比例分别为98.96%、98.20%、99.57%。公司咨询收入为公司销售人员或研发人员向客户提供半导体封装相关咨询服务，该项收入金额较小，未计提成本。

### 3、报告期内营业收入按地区划分情况

地区	2014年1-5月(元)	2013年度(元)	2012年度(元)
华北	386,788.91	3,952,390.42	1,429,955.04
华东	2,728,220.23	6,265,842.46	4,213,129.62
华南	470,427.27	1,197,606.73	472,102.48
西北	61,010.65	210,077.90	26,688.20
西南		34,188.04	19,743.60
合计	3,646,447.06	11,660,105.55	6,161,618.94

报告期内，公司销售收入主要来自于华东地区，2014年1-5月份、2013年度、2012年度，公司在该区域内实现的收入分别占当期收入总额的74.82%、53.74%、68.28%。我国半导体封装业在该区域内较为集中，公司销售收入符合我国半导体封装产业的区域分布。

#### 4、营业利润的变动趋势及原因

项目	2014年1-5月份	2013年度	2013年变动率	2012年度
营业收入	3,646,447.06	11,660,105.55	89.24%	6,161,618.94
营业成本	1,265,541.08	5,058,511.05	149.08%	2,030,892.67
毛利率	65.29	56.62	-15.54%	67.04
营业利润	-89,445.55	120,355.18	-83.17%	715,223.23
利润总额	17,554.45	346,693.18	-54.97%	769,863.23

2013年度、2012年度，公司营业收入分别为11,660,105.55元、6,161,618.94元，同比增长89.24%，实现了较大规模的上升。相较而言，2013年度、2012年度公司营业成本分别为5,058,511.05元、2,030,892.67元，同比增长149.08%。营业收入的增长率低于成本增长率，主要系由于公司2013年度产品的整体毛利率出现下降。

2013年度、2012年度，公司毛利率分别为56.62%、67.04%，同比下降15.54%，系由于2013年度公司开发的半导体芯片胶膜、LED硅胶投入市场，销售额共计约200万元，该两类产品生产过程中大量使用进口原材料，由于原材料价格较高，导致该等产品毛利较低，使得公司2013年度整体毛利率下滑。2014年公司放弃半导体胶膜材料产品，LED硅胶通过研发改进后转用国产原材料，在达到同等使用效果的情况下降低了材料成本，故2014年公司毛利回升。

2013年度、2012年度公司营业利润分别为120,355.18元、715,223.23元，同比下降83.17%，主要原因除上述毛利下降外，还包括2013年度公司研发费用投入增长幅度较大所致。相较而言，2013年度、2012年度公司利润总额分别为346,693.18元、769,863.23元，同比下降54.97%。利润总额的下降幅度小于营业利润，主要系由于2013年度公司计入当期损益的政府补贴大于2012年度。

#### 5、成本构成情况

(1) 报告期内成本构成及占比情况如下表：

项目	2014年1-5月		2013年度		2012年度	
	金额(元)	比例%	金额(元)	比例%	金额(元)	比例%
直接材料	595,674.72	50.80	3,685,740.78	72.66	1,169,341.92	56.22
直接人工	249,775.60	21.30	679,803.68	13.40	361,110.98	17.36
制造费用	327,139.77	27.90	707,299.46	13.94	549,391.64	26.42
合计	1,172,590.09	100.00	5,072,843.92	100.00	2,079,844.54	100.00

从上表可以看出直接材料是成本的主要影响因素，2013年度由于公司销售收入较2012年度有大幅度的提高，造成了制造费用比例大幅度的降低，直接材料成本出现较大幅度的增长；

### (2) 成本的归集、分配、结转方法

本公司成本按产品明细归集，由于公司产品流水线短，且采用订单式生产模式，期末没有在产品，成本全额计入产成品，成本结算方法为先进先出法。

### (三) 公司主要费用及变化情况

项目	2014年1-5月		2013年度		2012年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
销售费用	693,935.83	19.03	1,693,888.59	14.53	1,414,700.86	22.96
管理费用	1,727,908.25	47.39	4,537,482.40	38.91	1,902,738.58	30.88
财务费用	1,198.88	0.03	88,431.36	0.76	2,215.49	0.04
合计	2,423,042.96	66.45	6,319,802.35	54.20	3,319,654.93	53.88

2014年1-5月份、2013年度、2012年度公司销售费用、管理费用、财务费用总额分别为2,423,042.96元、6,319,802.35元、3,319,654.93元，占当期营业收入的比重分别为66.45%、54.20%、53.88%。总体来讲，公司2014年1-5月份上述费用占营业收入比例较高，系由于产品认证支出及研发费用支出增加。

2014年1-5月份、2013年度、2012年度公司销售费用分别为693,935.83元、1,693,888.59元、1,414,700.86元，占当期营业收入的比例分别为19.03%、14.53%、22.96%，处于较高水平。由于半导体材料行业的特殊性，在客户正式使用公司产品前将进行繁复的验证程序，将带来较大支出。2013年销售收入占营业收入比重下降主要系由于销售收入增长所致，2014年1-5月份较2013年度增长主要系由于公司新产品面世，为开拓市场所支出销售费用增加。

2014年1-5月份、2013年度、2012年度公司管理费用分别为1,727,908.25元、4,537,482.40元、1,902,738.58元，占当期销售收入的比例分别为47.39%、38.91%、30.88%，呈持续增长之势，主要是由于公司目前尚处于成长初期，各类产品体系初步形成，但产品种类并不完善，因此公司持续加大对研发费用的投入，导致研发费用占销售收入比例不断增加。

其中，2014年1-5月份、2013年度、2012年度研发费用支出分别为732,504.65元、2,187,726.74元、887,815.87元，占当期销售收入的比例分别为20.09%、18.76%、14.41%，持续递增。具体情况如下：

项目	2014年1-5月		2013年度		2012年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
研发支出	732,504.65	20.09	2,187,726.74	18.76	887,815.87	14.41

2014年1-5月份、2013年度、2012年度公司财务费用分别为1,198.88元、88,431.36元、2,215.49元，占当期营业收入的比例分别为0.03%、0.76%、0.04%。2013年财务费用占营业收入比例略高系由于公司2012年发生为期一年的短期借款共170万元产生的利息支出。从整体来讲，公司财务费用处于较低水平。

#### （四）非经常性损益情况

##### 1、非经常性损益明细

项目	2014年1-5月份	2013年度	2012年度
（1）非流动性资产处置损益			
（2）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
（3）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	107,000.00	226,140.00	54,640.00
（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
（5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
（6）非货币性资产交换损益			
（7）委托他人投资或管理资产的损益			

(8) 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
(9) 债务重组损益			
(10) 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等			
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,827.43	-22,949.54	-13,360.21
(16) 对外委托贷款取得的损益			
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
(19) 受托经营取得的托管费收入			
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		198.00	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目			
非经常性损益合计	112,827.43	203,388.46	41,279.79

## 2、非经常性损益与净利润

项目	2014 年 1-5 月份	2013 年度	2012 年度
非经常性损益 (元)	112,827.43	203,388.46	41,279.79
净利润 (元)	14,921.29	259,067.31	701,930.29
非经常性损益占净利润比例	756.15%	78.51%	5.88%

扣除非经常性损益后净利润(元)	-97,906.14	55,678.85	660,650.50
-----------------	------------	-----------	------------

公司 2014 年 1-5 月份非经常损益占净利润的比例为 756.15%，扣除非经常性损益后的净利润为负数，主要原因有二：其一是行业季节性所致，一般该行业下半年销售收入明显高于上半年；其二是公司持续加大研发投入，2014 年 1-5 月份研发投入占销售收入 20%以上，相较于 2012 年、2013 年的 14.41%、18.76%有一定增长。

公司在报告期内研发支出持续增加，导致净利润下滑，但是作为以研发为核心的高新技术企业，持续的高水平产品研发能力是公司长足发展的基本保证。虽然，在短期内公司出现利润下滑现象，但是公司产品已取得良好应用效果及市场反应，未来公司的利润增长将得益于不断增加的研发投入。另外，由于季节性原因，公司上半年销售收入较低，公司 2013 年 1-5 月份收入为全年收入的 36.31%，随着下半年的经营，这一状况将得到改善。

因此，公司 2014 年 1-5 月份扣除非经常性损益后净利润为负数只是暂时性现象，并不对持续经营能力产生重大不利影响。

### 3、非经常性损益列报项目

报告期内，公司非经常性损益列报于利润表的营业外收入、营业外支出和资产减值损失。

#### ①营业外收入情况

报告期内，公司营业外收入情况如下：

项目	2014 年 1-5 月 (元)	2013 年度 (元)	2012 年度 (元)
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
捐赠利得			
政府补助利得	107,000.00	226,140.00	54,640.00
其他（违约金收益）		200.00	
合计	107,000.00	226,340.00	54,640.00

2014年1-5月份、2013年度、2012年度，公司营业外收入金额分别为107,000.00元、226,340.00元、54,640.00元，占公司当期净利润的比例分别为717.10%、87.37%、7.78%，主要为政府财政补贴。报告期内，公司获得的计入当期损益的政府财政补贴情况如下：

补助项目	2014年1-5月(元)	2013年度(元)	2012年度(元)
塘沽天使基金		100,000.00	50,000.00
天津市科委创新基金		50,000.00	
海洋高新区专利资助费			3,000.00
滨海生产力促进中心专利资助费			1,640.00
天津市财政局贴息		50,000.00	
高新技术企业补贴	100,000.00	20,000.00	
专利资助费		6,140.00	
商标奖励	7,000.00		
合计	107,000.00	226,140.00	54,640.00

注1：依据与天津市滨海新区塘沽管理委员会签订的《半导体塑封模具用橡胶清润模材料研发与中试生产》，2012年度计入“营业外收入-政府补助”50,000.00元，于2013年度收到合同资助尾款100,000.00元，计入“营业外收入-政府补助”。

2：依据与天津市滨海新区塘沽管理委员会签订的《天津市科技计划项目(课题)任务合同书》，公司于2012年收到天津市科委创新基金150,000.00元，其中50,000.00元用于补助能源材料费，100,000.00元用于购买设备，公司于2013年将用于补助能源材料费的50,000.00元计入“营业外收入-政府补助”科目。

3：依据《塘沽鼓励科技型中小企业发展扶持办法》以及《天津市滨海新区塘沽科技型中小企业发展专项资金使用办法》，公司于2012年收到专利资助费4,640.00元；于2013年收到天津市财政局贴息50,000.00元，收到高新技术企业补贴20,000.00元，收到专利资助费6,140.00元；于2014年收到高新技术企业政府补助100,000.00元，收到商标补助7,000.00元；上述补助均属于与收益相关的补贴。

## ②营业外支出情况

报告期内，公司营业外支出情况如下：

项目	2014年1-5月(元)	2013年度(元)	2012年度(元)
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
非常损失			
盘亏损失			
其他(调整供应商预付款零头差额)		2.00	
合计		2.00	

### ③资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失情况如下：

	2014年1-5月	2013年度	2012年度
坏账损失	-5,827.43	22,949.54	13,360.21

公司资产减值损失均为计提坏账，2014年1-5月份为负数系由于以往期间计提的坏账收回。

## 九、报告期内公司现金流量情况

### (一) 经营活动现金流量情况

	2014年1-5月	2013年度	2012年度
销售商品、提供劳务收到的现金	4,329,814.58	13,357,743.23	6,938,943.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	107,647.62	190,565.05	696,647.84
经营活动现金流入小计	4,437,462.20	13,548,308.28	7,635,590.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,350,764.64	4,799,849.37	2,391,008.90
支付给职工以及为职工支付的现金	1,725,922.21	2,663,610.59	1,466,224.85
支付的各项税费	505,864.73	1,304,236.47	815,176.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,170,814.03	4,569,039.89	2,880,578.20

经营活动现金流出小计	4,753,365.61	13,336,736.32	7,552,988.20
经营活动产生的现金流量净额	-315,903.41	211,571.96	82,602.68

### 1、商品、提供劳务收到的现金

项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
营业收入	3,646,447.06	11,660,105.55	6,161,618.94
增值税销项税额	587,943.22	1,950,619.09	1,042,938.20
预收账款的增加	-17,120.00	103,650.00	1,590.00
应收款项的增加	-112,544.30	356,631.41	267,204.10
合计	4,329,814.58	13,357,743.23	6,938,943.04

### 2、其他与经营活动有关的现金

项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
利息收入	647.62	14,225.05	1,967.82
政府补助	107,000.00	176,340.00	644,640.00
往来款			50,040.02
合计	107,647.62	190,565.05	696,647.84

### 3、商品、接受劳务支付的现金

项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
营业成本	1,265,541.08	5,058,511.05	2,030,892.67
增值税进项	159,179.46	867,652.47	365,501.75
存货的增加	40,297.90	-21,403.44	274,972.27
预付账款的增加	186,455.19	-135,650.60	270,186.39
成本中的工资福利支出	249,775.60	679,803.68	361,110.98
成本中的折旧费	133,583.58	198,024.86	81,428.12
应付款项的增加	-82,650.19	91,431.57	108,005.08
合计	1,350,764.64	4,799,849.37	2,391,008.90

### 4、其他与经营活动有关的现金

项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
往来款	19,594.80	1,130,498.85	326,179.80
手续费	1,846.50	3,824.70	3,244.14

管理费费用	744,767.90	2,325,887.06	1,333,575.88
销售费用	404,604.83	1,105,827.28	1,217,578.38
营业外支出		2.00	
冻结押金		3,000.00	
合计	1,170,814.03	4,569,039.89	2,880,578.20

## (二) 投资活动现金流量

报告期内，公司投资活动现金流量仅为构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，具体如下：

项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
购建固定资产	85,042.72	1,043,003.41	362,959.42
合计	85,042.72	1,043,003.41	362,959.42

## (三) 筹资活动现金流量

项目	2014年1-5月	2013年	2012年
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	2,000,000.00	
取得借款收到的现金		1,450,000.00	1,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	3,450,000.00	1,700,000.00
偿还债务支付的现金		3,150,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,831.71	939.17
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,248,831.71	939.17
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,000.00	201,168.29	1,699,060.83

### 1、吸收投资收到的现金

2013年，公司注册资本由100万增加值300万，收到投资款200万元；2014年公司注册资本由300万元增加值400万元，收到投资款100万元。

### 2、取得价款收到的现金

2012年，公司向农业银行借款70万元，向股东谭晓华借款100万元，2012年取得借款收到的现金共计170万元，该借款于2013年偿还。

2013年，公司向农业银行借款145万元，于当年偿还，2013年取得借款收到的现金145万元，偿还债务支付的现金共计315万元。

## 十、公司的税收优惠情况及财政补贴情况

### （一）公司报告期内适用的主要税（费）种和税（费）率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	当期应税收入	17.00
城市维护建设税	应交流转税额	7.00
教育费附加	应交流转税额	3.00
地方教育费附加	应交流转税额	2.00
防洪费	应交流转税额	1.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00
其他税项	按税法有关规定计缴	

### （二）公司享受的税收优惠政策

根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），认定（复审）合格的高新技术企业，自认定（复审）批准的有效期限当年开始，可申请享受企业所得税优惠，本公司于2012年12月8日取得《高新技术企业证书》，证书编号GR201212000248，有效期三年，本公司2012年-2014年享受所得税税率为15%的税收优惠。

### （三）报告期内公司接受财政补贴情况

#### 1、2012年度

项目	年初余额	新增补助	计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	备注
塘沽天使基金	188,642.36		50,000.00	138,642.36		收益相关 (注：1)
国家科技部创新基金		490,000.00			490,000.00	资产相关 (注：2)
天津市科委创新基金		150,000.00			150,000.00	资产相关 (注：3)
海洋高新区专利资助费		3,000.00	3,000.00			收益相关 (注：4)

滨海生产力促进中心专利资助费		1,640.00	1,640.00			收益相关 (注：4)
合计	188,642.36	644,640.00	54,640.00	138,642.36	640,000.00	

## 2、2013 年度

项目	年初余额	新增补助	计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	备注
塘沽天使资金		100,000.00	100,000.00			收益相关 (注：1)
国家科技部创新基金	490,000.00				490,000.00	资产相关 (注：2)
天津市科委创新基金	150,000.00		50,000.00		100,000.00	资产相关 (注：3)
天津市财政局贴息（		50,000.00	50,000.00			收益相关 (注：4)
高新技术企业补贴（注释：3）		20,000.00	20,000.00			收益相关 (注：4)
专利资助费		6,140.00	6,140.00			
合计	640,000.00	176,140.00	226,140.00		590,000.00	

## 3、2014 年 1-5 月份

项目	年初余额	新增补助	计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	备注
国家科技部创新基金	490,000.00				490,000.00	资产相关 (注：2)
天津市科委创新基金	100,000.00				100,000.00	资产相关 (注：3)
高新技术企业政府补助		100,000.00	100,000.00			收益相关 (注：4)
商标奖励		7,000.00	7,000.00			收益相关 (注：4)
合计	590,000.00	107,000.00	107,000.00		590,000.00	

注 1：依据与天津市滨海新区塘沽管理委员会签订的《半导体塑封模具用橡胶清润模材料研发与中试生产》，公司与 2011 年收到塘沽天使基金 300,000.00 元，2012 年度计入“营业外收入-政府补助”50,000.00 元；于 2013 年度收到合

同资助尾款 100,000.00 元，计入“营业外收入-政府补助”。

2：依据与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心签订的《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同》，公司于 2012 年取得国家科技部创新基金 490,000.00 元，依据合同约定，该款项计入“专项应付款”核算，其中：消耗部分予以核销，形成资产部分转入“资本公积”。报告期内，公司专项应付款情况如下：

项目	2014 年 5 月 31 日（元）	2013 年 12 月 31 日（元）	2012 年 12 月 31 日（元）
国家科技部创新基金	490,000.00	490,000.00	490,000.00
合计	490,000.00	490,000.00	490,000.00

3：依据与天津市滨海新区塘沽管理委员会签订的《天津市科技计划项目（课题）任务合同书》，公司于 2012 年收到天津市科委创新基金 150,000.00 元，其中 50,000.00 元用于补助能源材料费，100,000.00 用于购买设备，公司于 2013 年将用于补助能源材料费的 50,000.00 元计入“营业外收入-政府补助”科目。报告期内，公司该项补贴计入其他非流动负债，具体情况如下：

项目	2014 年 5 月 31 日（元）	2013 年 12 月 31 日（元）	2012 年 12 月 31 日（元）
天津市科委创新基金	100,000.00	100,000.00	150,000.00
合计	100,000.00	100,000.00	150,000.00

4：依据《塘沽鼓励科技型中小企业发展扶持办法》以及《天津市滨海新区塘沽科技型中小企业发展专项资金使用办法》，公司于 2012 年收到专利资助费 4,640.00 元；于 2013 年收到天津市财政局贴息 50,000.00 元，收到高新技术企业补贴 20,000.00 元，收到专利资助费 6,140.00 元；于 2014 年收到高新技术企业政府补助 100,000.00 元，收到商标补助 7,000.00 元；上述补助均属于与收益相关的补贴。

## 十一、关联方、关联方关系及关联方交易情况

### （一）关联方及其关联关系

报告期内，公司存在以下关联方：

主要关联方	与公司的关联关系
谭晓华、霍炬、孙巨龙、方玉辉、李湘风、连爱琪、翟玉静	报告期内（曾）持有公司 5%以上股权的股东

谭晓华、霍炬、孙巨龙、方玉辉、冯亚凯、孙绪筠、沈六富、李永、潘雪莹	公司的董事、监事、高级管理人员
天津齐泰科技有限公司、天津齐泰国际贸易有限公司	公司主要投资人近亲属控制的其他企业

截至 2014 年 5 月 31 日，李湘风、连爱琪、翟玉静持有的有限公司股权已全部转让。

天津齐泰科技有限公司现有股东项淑芳、刘素艳二人，分别持股 50%，项淑芳在该公司担任执行董事并经理，方玉辉在该公司担任监事。项淑芳为方玉辉之母。该公司基本情况如下：

名称	天津齐泰科技有限公司
注册号	120191000080745
类型	有限责任公司
法定代表人	项淑芳
注册资本	100 万元人民币
成立日期	2003 年 1 月 15 日
住所	天津市滨海新区天津开发区第四大街 95 号 5 门 205 室
经营范围	电子产品及零部件、五金、橡胶、塑料制品、包装制品、化工产品（危险化学品及易制毒品除外）、高分子材料、建筑、装饰材料、办公用品、机械配件批发兼零售；软件开发。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

天津齐泰国际贸易有限公司由项淑芳出资 66 万元、方玉辉出资 34 万元，项淑芳担任该公司执行董事并经理，方玉辉担任监事。项淑芳为方玉辉之母。该公司基本情况如下：

名称	天津齐泰国际贸易有限公司
注册号	120192000056929
类型	有限责任公司
法定代表人	项淑芳
注册资本	100 万元人民币
成立日期	2005 年 1 月 28 日
住所	天津市滨海新区天津保税区东方大道 88 号 1-403-1 室
经营范围	国际贸易，货物及技术的进出口，简单加工，代办保税仓储，电子产品及

	零配件、高分子材料、五金、橡胶制品、机械配件的经营，及相关的咨询服务（国家有专项、专管规定的，按规定执行）
--	---

## （二）关联方交易情况

根据交易的内容、性质、交易频率将公司与关联方发生的交易区分为经常性和偶发性的关联交易。经常性关联交易主要是公司与关联方发生的采购、销售等与日常经营业务相关的、发生频繁的交易，反之则为偶发性关联交易。

公司报告期内发生的向销售业务属于经常性的关联交易，未来将持续发生，采购业务及关联方借款、关联方向公司提供担保属于偶发性的关联交易，未来不会持续发生。报告期内公司发生的关联交易如下：

### 1、销售商品的关联交易

#### ①2014 年 1-5 月份

单位名称	关联交易内容	金额	占同类产品比例 (%)	定价政策
天津齐泰科技有限公司	销售半导体橡胶润模片 2.7mm	40,000.00	100.00	平均销售价格 751.88 元/公斤
	销售半导体橡胶润模片 3mm	102,564.10	100.00	平均销售价格 488.40 元/公斤
	销售半导体橡胶清模片 7mm	233,442.76	9.43	平均销售价格 126.81 元/公斤，同区同类产品对其它客户和代理商销售的平均售价为 102.36 元/公斤
	销售半导体树脂溶解剂	1,282.05	100.00	平均销售价格 854.70 元/公斤
天津齐泰国际贸易有限公司	销售半导体橡胶润模片 225mm*15mm*8mm/W150mm	9,500.00	100.00	平均销售价格 105.55 元/公斤
合计		386,788.91		

#### ②2013 年度

单位名称	关联交易内容	金额	占同类产品比例 (%)	定价政策
天津齐泰科技有限公司	销售半导体橡胶润模片 2.7mm	80,000.00	100.00	平均销售价格 766.28 元/公斤
	销售半导体橡胶	164,102.56	100.00	平均销售价格 488.40 元/公斤

	润模片 3mm			
	销售半导体橡胶清模片 7mm	1,562,502.35	19.95	平均销售价格 147.00 元/公斤，同区同类产品对其它客户和代理商销售的平均售价为 108.84 元/公斤
	销售橡胶清模产品 (<2.7mm)	2,100,054.76	100.00	平均销售价格 544.30 元/公斤
	销售半导体树脂溶解剂	2,564.10	86.00	销售价格 854.70/公斤，与其他客户同价
天津齐泰国际贸易有限公司	销售半导体橡胶润模片 225mm*15mm*8mm/W150mm	34,883.32	100.00	平均销售价格 105.56 元/公斤
合计		3,944,107.09		

## ③2012 年度

单位名称	关联交易内容	金额	占同类产品比例 (%)	定价政策
天津齐泰科技有限公司	销售半导体橡胶润模片 2.7mm	60,000.00	100.00	平均销售价格 766.28 元/公斤
	销售半导体橡胶润模片 3mm	249,415.39	100.00	平均销售价格 494.87 元/公斤
	销售半导体橡胶清模片 7mm	1,078,420.00	21.11	平均销售价格 162.73 元/公斤，同区同类产品对其它客户和代理商销售的平均售价为 111.40 元/公斤
	销售半导体树脂溶解剂	7692.30	81.00	平均销售价格 854.70 元/公斤，其他客户该产品平均价格 948.00 元/公斤。
天津齐泰国际贸易有限公司	销售半导体橡胶润模片 225mm*15mm*8mm/W150mm	34,000.00	100.00	平均销售价格 108.97 元/公斤
	销售半导体树脂溶解剂	427.35	4.50	平均销售价格 854.70 元/公斤，其他客户该产品平均价格 948.00 元/公斤。
合计		1,429,955.04		

报告期内，公司向关联方销售产品主要为半导体清模润模橡胶，公司所有清模润模材料按产品“厚度”规格划分有 2.7mm、3mm、5mm、6mm、7mm、8mm、10mm 等规格，其中 7mm 为公司市场多数客户需求的标准产品规格。

该产品的生产经过混炼，挤出、成型几个工艺，成品从挤出机出来的厚度决定了单位时间产出效率，产品越薄，生产越困难，成品率越低，同时公摊的人工成本、机器折旧等费用越高。所以产品成本、售价与产品厚度呈反比。如与公司代理商齐泰科技合作的中电智能卡有限责任公司，为公安部指定的第二代身份证制造厂商，该智能卡产品半导体芯片非常薄，其使用的特殊设备要求清模润模材料必须 3mm 以下厚度才能工作。其中 2.7mm 和 3mm 产品均为齐泰科技独家销售，由于该产品成产成本高，因而定价较高。公司这款超薄产品提交已获国家发明专利，为市场独有设计，不存在竞争对手。

同等厚度规格的产品，由于产品技术指标的不同，销售价格亦不相同。以齐泰销售的 7mm 规格产品为例，其产品终端客户为威世通用半导体（中国）有限公司（原为通用半导体（中国）有限公司，后被美国 Vishay 集团收购），该公司半导体封装用途为生产大功率器件，该行业使用传统单注塑推杆的高压注塑机。高压注塑机的成型压力为 150kg/cm<sup>2</sup>以上，普通清模材料在模腔会被压力破坏而不能整片取出，操作工需用气枪反复吹扫模具表面清除残余的清模材料，甚至要人工抠挖被高压粘合在模具面的橡胶残留。所以公司针对此类高压用途开发了特殊的产品，耐压表现是同类产品最优，相对其他材料而言成本较高，因此售价更高。报告期内，齐泰科技所销售的 7mm 产品均为该型号的特殊定制产品，且为独家销售。

齐泰国贸报告期内代理公司 8mm 规格产品，其终端客户为哈尔滨海格集团有限公司，该产品为特殊定制产品，报告期内仅齐泰国贸一家客户，且销量较小，定价与 7mm 产品平均售价差别不大。

关联方齐泰科技、齐泰国贸是专门从事半导体封装材料销售的贸易公司，在行业内拥有丰富的客户资源；同时由于以上客户封装工艺的特殊性，对定制产品有较高的技术要求，需要技术人员长期跟踪服务，目前公司人力资源无法满足；另外以上终端使用者无法满足公司对客户的一般信用政策。

综上所述，公司向关联方销售的产品是必要的，未来会持续发生。该等关联

交易定价公允，不存在因该等交易损害公司及其他股东利益的情况。

## 2、采购材料的关联交易

报告期内，公司仅 2013 年向关联方齐泰科技采购原材料，具体情况如下：

单位名称	关联交易内容	金额	占同类产品比例 (%)	定价政策
天津齐泰科技有限公司	采购半导体清润模橡胶原料（日本进口合成橡胶）	2,100,054.68	61.00	为齐泰公司根据公司指定原材料的委托加工海外订单
合计		2,100,054.68		

公司 2013 年向齐泰科技采购的材料系委托齐泰科技向日本三井化学定制的材料，该业务的发生具有偶然性，不属于经常性关联交易。

由于在定制过程中需要专门人员跟踪材料生产状况，而公司人力资源相对紧张，故由齐泰科技向三井化学采购后向公司销售。

公司向齐泰科技采购的原料经过了公司研发及制造部门对材料的认证，确定了国外供应商并完善了建档程序。同时，公司向材料生产商进行了询价，并在询价基础上给予关联方一定比例价格增幅。公司从天津齐泰科技有限公司的采购流程符合公司一般采购流程。

因此，公司向关联方的采购是公允和必要的，未来不具有持续性。

## 3、向关联方借款

关联方	拆借金额	起始日	到期日	备注
谭晓华	1,000,000.00	2012 年 12 月 18 日	2013 年 12 月 18 日	年利息 3 万元

公司由于资本规模小，融资途径少，缺乏流动资金而向关联方借款。

公司与谭晓华签订的借款合同约定年利率为 6%，实际向谭晓华支付利息 3 万元。谭晓华已作出承诺，放弃另外 3 万元利息收益。公司向谭晓华借款，约定利率与同期中国人民银行贷款基准利率相符，且公司实际向谭晓华支付利息为 3 万元，不存在控股股东因该交易损害公司及其他股东利益的情形。

因此，公司向关联方借款是公允和必要的。

## 4、关联方往来款余额

项目名称	关联方	2014 年 5 月 31 日(元)	2013 年 12 月 31 日(元)	2012 年 12 月 31 日(元)
------	-----	--------------------	---------------------	---------------------

其他应付款	翟玉静	8,026.09		21,151.00
其他应付款	谭晓华	6,682.45	8,350.00	
其他应付款	李湘风		11,049.99	839,964.55
其他应付款	孙绪筠	7,306.00		
其他应付款	潘雪莹	8,832.00		
应收账款	天津齐泰科技有限公司	92,822.00	225,097.75	190,710.00
应收账款	天津齐泰国际贸易有限公司			7,410.00

报告期各期末，公司与关联方其他应付款余额较低，均为该等关联方处理公司事务垫付款项，公司对应付关联方款项不存在依赖，也不存在关联方因该交易损害公司利益的情形。2012年12月31日，公司与李湘风其他应付款余额为839,964.55元，系由于公司资金周转紧张而向股东临时拆借的款项，款项拆借事项未约定利息，未经公司内部相关审批。

报告期内，公司应收关联方账款均为公司向关联方销售商品，在正常信用周期内产生的账款，不存在关联方侵害公司利益的情况。公司给予关联方的信用期为1个月，与其他主要客户一致。

因此，公司与关联方的往来是公允和必要的。

## 5、关联方担保

担保人	担保权人	合同编号	抵押物	抵押物价值	担保范围
谭晓华	中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行	12100220120008917	房地证津字第114021203148号	157万元	合同编号为12010120120001079的流动资金贷款合同项下105万元借款
方玉辉	中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行	12100220120008918	房地证津字第114021004309号	166万元	合同编号为12010120120001079的流动资金贷款合同项下110万元借款

2012年，公司由于缺乏流动资金向银行借款，由谭晓华、方玉辉以个人房产抵押为公司提供担保，未收取公司担保费用，亦未因此获得任何来自公司的利益。该担保行为不存在关联方侵害公司利益的行为。

因此，关联方为公司提供担保是公允的。公司未向关联方支付担保费用虽不

公允，但未损害公司利益。

## 6、关联交易决策程序

以上关联交易均发生在有限公司阶段，当时公司治理结构不够完善，相关管理制度亦不完善，公司章程未对关联交易决策程序作出规定，因此以上关联交易未履行决策程序。

2014年7月18日，公司召开股东大会，通过了《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易管理制度》等相关规章制度，从而在关联交易决策方面有了制度层面的保证。今后，公司在规范关联交易方面将严格遵照相关制度进行决策、表决。

## 十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

截至2014年7月11日（报告批出日），公司无需要披露的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项。

## 十三、报告期内资产评估情况

报告期内，公司未进行资产评估。

## 十四、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况

### （一）公司的股利分配政策

《公司章程》对公司的股利分配政策做出了较为完善的规定，具体如下：

《公司章程》第144条规定：

公司的股利分配政策为：

1、利润分配原则为：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；

2、利润分配形式为：公司采取积极的现金或股票股利分配政策，视公司经营和财务状况，可以进行中期分配；

3、公司董事会未作出现金利润分配预案的，应在近期定期报告中披露原因。

存在股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司董事会在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上，制定利润分配方案；监事会应当对利润分配方案进行审核并发表审核意见。

《公司章程》第 141 条规定：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定的不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

《公司章程》第 143 条规定：

公司股东大会对利润分配做出分配方案决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

## （二）公司报告期内的鼓励分配情况

报告期内，公司未进行股利分配。

## 十五、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司无控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

## 十六、特有风险提示

### （一）控股股东控制的风险

公司股东谭晓华持有公司股份 272 万股，占股份总数的 68%，系公司的控股股东。此外，谭晓华担任公司董事长、总经理，能够决定或实质影响公司的经营方针、决策和经理层的任免。若谭晓华利用其控制地位对公司的经营、管理、人事、财务进行不当控制，则或将损害公司及其他股东的利益。

### （二）产品研发风险

2014 年 1-5 月份、2013 年度、2012 年度，公司的研发费用分别为 73.25 万元、218.77 万元、88.78 万元，占公司营业收入的比例分别为 20.09%、18.76%、

14.41%，投入金额较大。

公司电子化学品具有品种多、批量少、升级快、研发投入大、周期长、风险高等特点，需要持续开发和创新。产品研发测试成功后，进行大规模生产时，任何设备工艺参数缺陷、员工素质差异等都可能对产品品质波动，面临产品难以规模化生产风险。同时，新产品研制成功及实现大规模生产后，还面临着市场推广风险。

虽然公司掌握核心技术，并在电子化学品研发及生产领域拥有丰富的经验，但是如果未来研发的新产品不能按计划实现规模化生产或市场环境、市场需求出现重大不利变化导致不能产生预期收益，则公司每年较高的研发投入水平将对公司未来业绩造成一定压力。

### （三）技术泄密风险

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有授权发明专利 4 项，已获受理的专利申请 2 项；同时，在不断研发的过程中，公司还形成了较多的非专利技术和核心配方，这些技术和配方都是公司技术领先的保证。

公司自成立以来就非常注重对专利、非专利技术和新配方的保护，为了保证公司的核心机密不外泄，公司与董事、监事、高级管理人员、所有研发人员以及其他相关人员均在劳动合同中约定了保密条款。公司采取了配方保密、专人保管等特殊方法，并通过岗位分离及权限设置，避免部分技术人员掌握全部核心技术内容，从而有效保护了技术秘密。如果出现任何侵犯本公司专利或相关知情人士违反保密义务的情形，可能对公司的正常经营产生不利影响。

### （四）核心技术人员流失的风险

作为一家立足于技术的高科技企业，拥有稳定、高素质的技术人才队伍是公司长期发展的关键，本公司自成立以来，一贯注重研发人才的培养，为技术开发人员提供了良好的薪酬福利，制定了多种政策鼓励创新和研发，并与核心技术人员签订了保密协议。但随着市场竞争的日益激烈，对核心技术人才的争夺将日趋激烈，如果公司未来不能再公司前景、薪酬、福利和工作环境等方面持续提供具有竞争力的机制，将可能会造成公司核心技术人员的不稳定，从而对本公司的长远发展造成不利影响。

### （五）新产品市场推广风险

公司已掌握 LED 灯丝灌封胶、FPS 指纹传感器封装 EMC 等高端电子化学品制造的核心技术，解决了产业化过程中规模化生产的关键技术难题，正在进行市场推广。LED 灯丝灌封胶、FPS 指纹传感器封装用 EMC 等属于高端半导体封装的关键工艺材料，由于国内一直未能掌握相关化学材料技术，国内先进半导体封装测试企业相关材料需求全部依赖进口。由于半导体封装测试工艺对环境、材料的严格要求，半导体封装企业一般选择认证合格的供应商保持长期合作，从而降低材料供应商变化可能导致的产品质量风险；同时，新的材料供应商必须通过半导体封装企业严格的公司和产品评估才能成为其合格供应商。

因此，公司 LED 灯丝灌封胶、FPS 指纹传感器等新产品大规模市场销售市场推广面临客户的认证意愿、对公司质量管理能力的认可以及严格的产品认证等不确定因素，存在一定的市场推广风险。

### （六）半导体产业周期性、季节性波动风险

半导体产业具有技术呈周期性发展和市场呈周期性波动的特点。公司主营业务处于半导体产业链的材料支撑行业，其市场需求和全球及国内半导体产业的发展状况息息相关，因此，公司的业务发展会受到半导体行业周期性波动的影响。未来，如果全球及国内半导体行业进入发展低谷，则公司将面临业务发展放缓、业绩产生波动的风险。

公司所在电子化学品细分领域主要为半导体产业配套，受半导体市场波动影响较大。半导体行业的终端产品消费电子、家用电器、信息通讯等在节假日几乎全部存在促销活动，销售也会比平时答复增加。而全年的节假日，除了五一，其余如十一、元旦、春节，包括国外的圣诞节都在下半年，故下半年日常的电子用品销量会高于上半年。同时，公司客户一般在年末或年初启动增产计划并在下半年实现大批量投产。因此，公司产品销售在年度内存在上半年低下半年高的季节性波动风险。

### （七）关联交易风险

2014 年 1-5 月份、2013 年度、2012 年度，公司向关联方天津齐泰科技有限公司销售产品金额分别为 36.68 万元、394.41 万元、143.00 万元，分别占当期公司销售收入的 10.06%、33.83%、23.31%。由于有限公司时期，法人治理结构尚

未完善，亦未对关联交易事项制定相关内部管理制度，故以上关联交易事项均未履行相关决策程序。股份公司成立以来，制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》，对关联交易的内部决策程序作出了明确的规范，尽管如此，如果公司未来不能充分履行上述规章制度，则可对公司经营带来风险。

#### （八）净资产收益率波动提示

2014年1-5月份、2013年度、2012年度，公司净资产收益率（加权平均）分别为0.45%、15.54%、74.32%，扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）分别为-2.96%、3.34%、69.95%，波动较大。2012年度净资产收益率较高系由于该年度公司实现扭亏为盈，公司加权平均净资产较低所致，2013年度净资产收益率有所下降系由于公司由于研发费用支出较大导致净利润较低，且2013年度公司实收资本由100万元增加值300万元。2014年1-5月份公司净资产收益率较低系由于行业季节性所致，一般上半年销售收入较低。随着公司产品体系的完善，未来销售收入将得到大幅提升，同时公司不断调整并优化资本结构，今后的净资产收益率将趋于平稳。

#### （九）税收政策变化风险

2012年11月8日，公司取得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》，有效期三年，证书编号为GR201212000248。根据高新技术企业所得税税收优惠的有关规定，在2012年度至2014年度公司使用15%的所得税税率。如果今后国家税务主管机关对所得税税收优惠政策做出调整，或者公司为持续获得高新技术企业资质，公司将不再享有上述税后优惠政策，这对公司未来的经营业绩和利润水平将会产生一定程度的影响，公司面临税收政策风险。

## 第五章 有关声明

### 一、申请挂牌公司及全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

董事：谭晓华 冯明 李耀 张成 孙清鹤

监事：张富 方永辉 李永

高级管理人员：谭晓华 隋雪莹 李瑾

天津德高化成新材料股份有限公司

2019年12月7日

## 二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人： 张优  
张优

项目小组成员： 张优      郭嘉恒      徐永军  
张优                      郭嘉恒                      徐永军

法定代表人： 刘汝军  
刘汝军



### 三、律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人（签名）：

经办律师（签名）：

周俊利  
牛宝源

  
崔炳全

北京市中银律师事务所

2014年12月1日



#### 四、会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人： 

签字注册会计师：  

大信会计师事务所(特殊普通合伙)  
2014年12月8日  
1101080210400



## 五、资产评估机构声明

本机构及经办注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人：

签字注册资产评估师： 

国众联资产评估土地房地产估价有限公司  
2014年12月9日  


## 第六章 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件